

# HC32F002 系列

32 位 ARM<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M0+ 微控制器

---

## 数据手册

Rev1.2 2022 年 10 月

## 产品特性

- 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
- HC32F002 系列具有灵活的功耗管理系统
  - 5µA @ 3V 深度休眠模式：所有时钟关闭，上电复位有效，IO 状态保持，IO 中断有效，所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗
  - 15µA/MHz@3V@48MHz 休眠模式：CPU 停止，外设处于可运行状态，主时钟运行
  - 100µA/MHz@3V@48MHz 工作模式：CPU 和外设可运行，从 FLASH 运行程序
- 18K 字节 FLASH 存储器，具有擦写保护功能，支持 ISP、ICP、IAP，4 级安全保护
- 2K 字节 RAM 存储器
- 通用 I/O 管脚 (22IO/24PIN, 18IO/20PIN)
- 时钟
  - 内部高速时钟 44.24/48MHz
  - 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
  - 外部输入 1-16MHz
- 定时器/计数器
  - 1 个复合定时器，可配置为通用 16 位定时器/计数器或 3 个 16 位基本定时器；作为通用定时器时支持 4 通道捕获比较，4 通道 PWM 输出；作为基本定时器时，每个定时器支持两路翻转输出
  - 1 个高级 16 位定时器，支持 3 相互补 PWM 输出
  - 1 个独立看门狗电路，内部低速时钟振荡器提供 WDT 计数
  - 1 个窗口看门狗电路，使用系统时钟
  - 1 个低功耗 16 位定时器，支持自动唤醒
  - 1 个 CM0+内置 24 位 SysTick 定时器
- 通讯接口
  - 2 路 LPUART 通讯接口
  - 1 路 SPI 标准通讯接口
  - 1 路 I2C 标准通讯接口
- 定时器作为蜂鸣器频率发生器
- 全球唯一 10 字节 ID 号
- 128 字节 OTP 存储器，只能通过编程器写入
- 10 位高达 1Msps 采样速率的 SARADC
- 集成低电压侦测器，可配置 16 阶比较电压，可监控端口电压以及电源电压
- SWD 调试解决方案，提供全功能调试器
- 工作条件：-20 ~ 105°C，1.7 ~ 5.5V
- 封装形式：QFN24/20，TSSOP24/20

### 支持型号：

HC32F002C4PZ-TSSOP20	HC32F002C4UZ-ZFN20TR
HC32F002D4PZ-TSSOP24	HC32F002D4UZ-QFN24TR
HC32F002C4PZ-TSSOP20TR	HC32F002D4PZ-TSSOP24TR

## 声 明

- ★ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2022 小华半导体有限公司 保留所有权利

## 目 录

产品特性.....	2
声 明.....	3
目 录.....	4
表索引.....	6
图索引.....	7
<b>1 简介 (Overview) .....</b>	<b>8</b>
<b>2 功能模块 .....</b>	<b>9</b>
2.1 功能模块框图 .....	9
2.2 32 位 Cortex M0+ 内核.....	10
2.3 存储器.....	10
2.3.1 18 Kbytes FLASH .....	10
2.3.2 2 Kbytes RAM.....	10
2.4 时钟系统 .....	10
2.5 工作模式 .....	11
2.6 端口控制器 GPIO .....	11
2.7 中断控制器 NVIC .....	11
2.8 复位控制器 RESET.....	11
2.9 定时器 TIM .....	11
2.10 看门狗 WDT .....	12
2.11 低功耗同步异步收发器 LPUART .....	12
2.12 串行外设接口 SPI .....	12
2.13 I2C 总线 .....	13
2.14 时钟校准器 CTRIM.....	13
2.15 蜂鸣器 Buzzer .....	13
2.16 模数转换器 ADC.....	13
2.17 低电压检测器 LVD .....	14
2.18 嵌入式调试系统.....	14
2.19 编程模式 .....	14
2.20 器件电子签名 .....	14
2.21 高安全性 .....	14
<b>3 产品阵容 .....</b>	<b>15</b>
3.1 产品名称 .....	15
3.2 功能 .....	16
<b>4 引脚配置及功能 .....</b>	<b>17</b>

4.1	引脚配置图.....	17
4.2	引脚功能说明.....	20
4.3	模块信号说明.....	21
<b>5</b>	<b>存储区映射图.....</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>典型应用电路图.....</b>	<b>25</b>
<b>7</b>	<b>电气特性.....</b>	<b>26</b>
7.1	测试条件.....	26
7.1.1	最小和最大数值.....	26
7.1.2	典型数值.....	26
7.2	绝对最大额定值.....	27
7.3	工作条件.....	28
7.3.1	通用工作条件.....	28
7.3.2	上电和掉电时的工作条件.....	28
7.3.3	内嵌复位和 LVD 模块特性.....	29
7.3.4	内置的参考电压 BGR.....	31
7.3.5	供电电流特性.....	31
7.3.6	从低功耗模式唤醒的时间.....	34
7.3.7	外部时钟源特性.....	34
7.3.8	内部时钟源特性.....	35
7.3.9	存储器特性.....	36
7.3.10	EFT 特性.....	36
7.3.11	ESD 特性.....	36
7.3.12	I/O 端口特性.....	37
7.3.13	RESETB 引脚特性.....	40
7.3.14	ADC 特性.....	41
7.3.15	TIM 定时器特性.....	43
7.3.16	通信接口.....	45
<b>8</b>	<b>封装信息.....</b>	<b>49</b>
8.1	封装尺寸.....	49
8.2	焊盘示意图.....	53
8.3	丝印说明.....	57
8.4	封装热阻系数.....	58
<b>9</b>	<b>订购信息.....</b>	<b>59</b>
	<b>版本修订记录.....</b>	<b>60</b>

## 表索引

表 4-1	模块信号说明.....	21
表 7-1	电压特性.....	27
表 7-2	电流特性.....	27
表 7-3	温度特性.....	27
表 7-4	通用工作条件.....	28
表 7-5	上电和掉电的工作条件.....	28
表 7-6	POR/Brown Out .....	29
表 7-7	LVD 模块特性.....	30
表 7-8	工作电流特性.....	31
表 7-9	端口输出特性.....	37
表 7-10	高级定时器 (ATIM) 特性.....	43
表 7-11	通用定时器特性 .....	43
表 7-12	低功耗定时器特性.....	44
表 7-13	IWDT 特性 .....	44
表 7-14	WWDT 特性 .....	44
表 7-15	I2C 接口特性.....	45
表 7-16	SPI 接口特性.....	46
表 8-1	各封装热阻系数表.....	58

## 图索引

图 4-1 引脚配置图 .....	19
图 7-1 POR/Brown Out 示意图 .....	29
图 7-2 输出端口 VOH/VOL 实测曲线 .....	38
图 7-3 I2C 接口时序 .....	45
图 7-4 SPI 时序图 (主机模式) .....	47
图 7-5 SPI 时序图 (从机模式 CPHA=0) .....	47
图 7-6 SPI 时序图 (从机模式 CPHA=1) .....	48

## 1 简介 (Overview)

HC32F002 系列是一款基础型通用的 32 位 MCU，具有宽电压工作范围。芯片集成 10 位高达 1Msps 采样速率的 SARADC、高性能 PWM 定时器、LPUART、SPI、I2C 等丰富的外设，具有低功耗、高可靠性、高整合度的特点。HC32F002 系列采用 Cortex-M0+内核，主频最大到 48MHz，配合成熟的 Keil 和 IAR 调试开发软件，支持使用 C 语言及汇编语言开发。

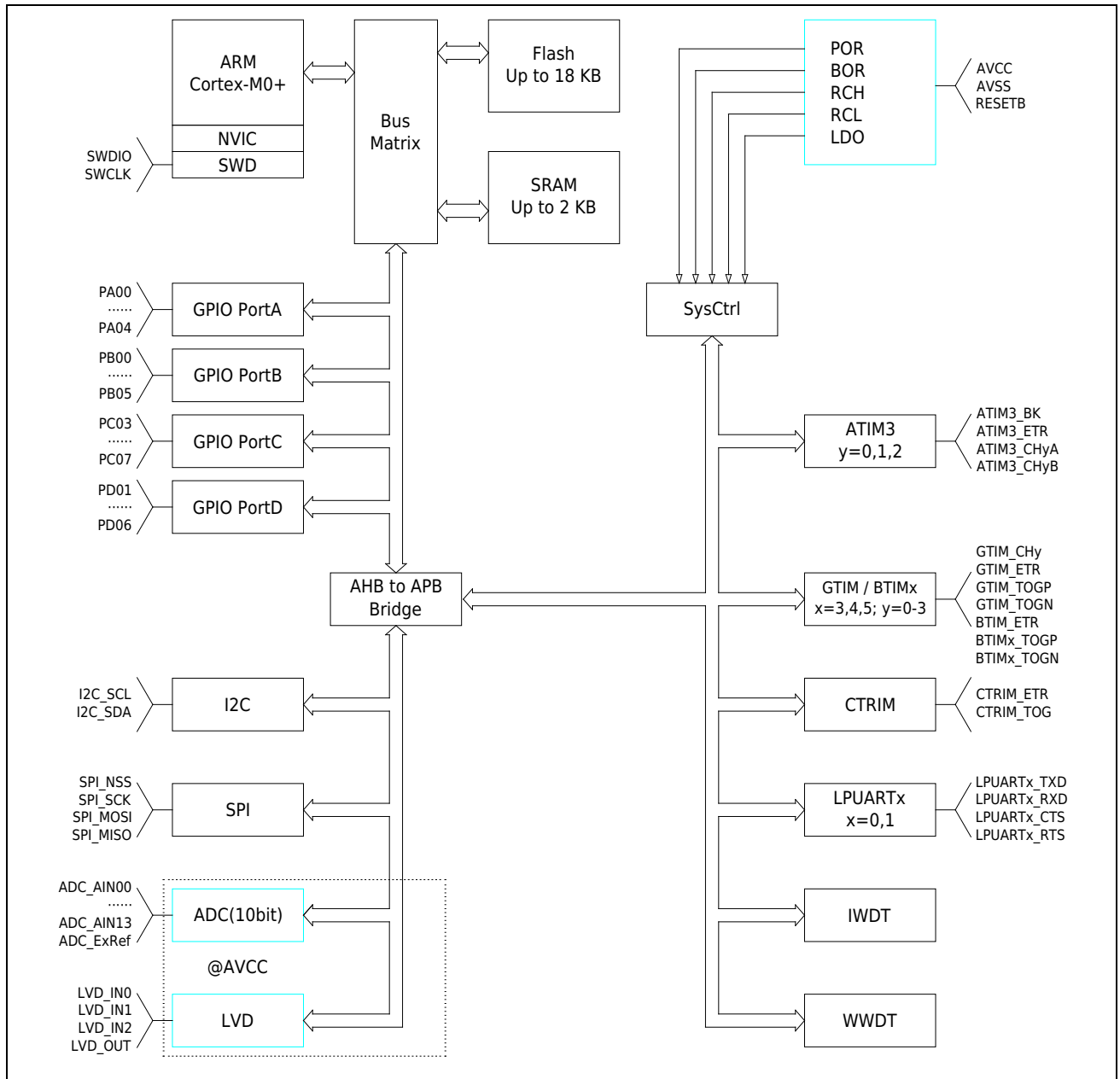
### 典型应用

- 电机控制、电池管理
- 智能家居、医疗设备
- 安防报警、智能交通
- 传感器模块、无线模块、货架标签



## 2 功能模块

### 2.1 功能模块框图



## 2.2 32 位 Cortex M0+ 内核

ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0，包含了一颗 32 位 RISC 处理器，运算能力达到 0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计，改进调试和追踪能力、减少每条指令循环（IPC）数量和改进 Flash 访问的两级流水线等，更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器。

Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路，支持 2-pin 的 SWD 调试接口。

ARM Cortex-M0+ 特性：

指令集	Thumb / Thumb-2
流水线	2 级流水线
性能效率	2.46 CoreMark / MHz
性能效率	0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone
中断	15 个快速中断
中断优先级	可配置 4 级中断优先级
增强指令	多周期 32 位乘法器
调试	Serial-wire 调试端口，支持 4 个硬中断（break point）以及 1 个观察点(watch point)

## 2.3 存储器

### 2.3.1 18 Kbytes FLASH

内建全集成 FLASH 控制器，无需外部高压输入，由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、ICP 功能。具有 4 级安全保护等级。

### 2.3.2 2 Kbytes RAM

任意功耗模式，RAM 数据均不会丢失。

## 2.4 时钟系统

一个频率为 44~48MHz 的高精度内部时钟 RCH。出厂已预置 44.24MHz、48MHz 校准值。

一个频率为 32.8KHz / 38.4KHz 的内部时钟 RCL。

一个频率为 1~16MHz 的外部输入高速时钟 EXTCLK。

## 2.5 工作模式

- 运行模式(Active Mode): CPU 运行, 片内外设运行。
- 休眠模式(Sleep Mode): CPU 停止运行, 片内外设运行。
- 深度休眠模式(Deep sleep Mode): CPU 停止运行, 低功耗片内外设运行。

## 2.6 端口控制器 GPIO

最多可提供 22 个 GPIO 端口, 其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制。所有管脚支持边沿触发中断和电平触发中断, 可从各种休眠模式下将 MCU 唤醒到工作模式。支持位置位、位清零、位置位清零操作。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻, 带有施密特触发器功能。每个 IO 最大支持 18mA 的电流驱动能力。

## 2.7 中断控制器 NVIC

Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器 (NVIC), 支持最多 15 个中断请求 (IRQ) 输入; 有四个中断优先级, 可处理复杂逻辑, 能够进行实时控制和中断处理。

## 2.8 复位控制器 RESET

本产品具有 7 个复位信号来源, 每个复位信号可以让 CPU 重新运行, 绝大多数寄存器会被重新复位, 程序计数器 PC 会指向起始地址。

## 2.9 定时器 TIM

类型	名称	位宽	预除频	计数方向	PWM	捕获	互补输出
高级定时器	ATIM3	16/32	1/2/4/8/16/ 32/64/256	上计数/ 下计数/ 上下计数	6	6	3
通用定时器	GTIM	16	1~32768	上计数	4	4	无
	BTIM3-5	16	1~32768	上计数	无	无	无
时钟校准器	CTRIM	16	1~32768	上计数	无	无	无

通用定时器是支持 4 路比较捕获功能的定时器, 可以配置成 3 个基本定时器。

低功耗定时器是异步 16 位定时/计数器, 在系统时钟关闭后仍然可以通 RCL 进行计时/计数。通过中断在低功耗模式下唤醒系统。

高级定时器包含定时器 ATIM3, 其特性如下:

- PWM 独立输出, 互补输出
- 捕获输入
- 死区控制

- 刹车控制
- 边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
- 正交编码计数功能
- 单脉冲模式
- 外部计数功能

ATIM3 是多通道的通用定时器，可以产生 3 组 PWM 互补输出或 6 路 PWM 独立输出，最多 6 路输入捕获。具有死区控制功能。

## 2.10 看门狗 WDT

IWDT 是一个可配置的 12 位定时器，在 MCU 异常的情况下提供复位；RCL 时钟输入作为计数器时钟。只有写入特定序列才能重启 WDT。

WWDT 是一个 7 位定时器，通常被用来监测，由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。

## 2.11 低功耗同步异步收发器 LPUART

2 路低功耗模式下可以工作的同步异步收发器（Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），LPUART0/LPUART1，其基本功能如下所示：

- 传输时钟 SCLK（SCLK 可选择 RCL 或 PCLK，时钟精度同 RCL 或 PCLK）
- 系统低功耗模式下收发数据
- 半双工和全双工传输
- 8/9-Bit 传输数据长度
- 硬件奇偶校验
- 1/1.5/2-Bit 停止位
- 四种不同传输模式
- 16-Bit 波特率计数器
- 多机通讯
- 硬件地址识别
- 硬件流控
- 支持单线模式

## 2.12 串行外设接口 SPI

- 可配置为主机或者从机，支持多机模式
- 主机模式最大分频系数为 PCLK/2，最高通信速率为 12M bps
- 从机模式最大分频系数为 PCLK/4，最高通信速率为 8M bps

- 多种通信模式：全双工、单线半双工、单工
- 两种传输顺序：先收发 MSB 或先收发 LSB
- 多种数据帧长度：4bit ~ 16bit
- 两种 NSS 方式：硬件控制、软件控制
- 可配置的串行时钟极性和相位

## 2.13 I2C 总线

1 路 I2C，采用串行同步时钟，可实现设备之间以不同的速率传输数据。

I2C 基本特性：

- 支持主机发送/接收，从机发送/接收四种工作模式
- 支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
- 支持 7 位寻址功能
- 支持噪声过滤功能
- 支持广播地址
- 支持中断状态查询功能

## 2.14 时钟校准器 CTRIM

时钟校准定时器可以调整校准 RC 时钟频率，也可以调整校准其他 RC 振荡的时钟频率，还可以作为一个通用定时器或者自动唤醒定时器来使用。

## 2.15 蜂鸣器 Buzzer

定时器功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 18mA 的 sink 电流，互补输出，不需要额外的三极管。

## 2.16 模数转换器 ADC

外部的模拟信号需要转变成数字信号才能由 MCU 进一步处理。内部集成了一个 10 位高精度、高转换速率的逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)模块。具有以下特性：

- 10 位转换精度；
- 1M SPS 转换速度；
- 支持单次转换及持续转换；
- 2 种参考源：AVCC 电压、ExRef 管脚；
- 15 路输入通道，包括 14 路外部管脚输入、1 路内建 BGR 0.9V 电压；

**注：**选择 AVCC 作为参考源，测量 BGR 0.9V；可计算出 AVCC 电压。

- ADC 的电压输入范围：0~Vref；

- 支持片内外设自动触发 ADC 转换，有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。

## 2.17 低电压检测器 LVD

对芯片电源电压或芯片管脚电压进行检测。16 档电压监测值 (1.8 ~ 3.3V)。可根据上升/下降边沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。

LVD 基本特性：

- 4 路监测源，AVCC、PA03、PC03、PD04；
- 16 阶阈值电压，1.8~3.3V 可选；
- 8 种触发条件，高电平、上升沿、下降沿组合；
- 2 种触发结果，复位、中断；
- 8 阶滤波配置，防止误触发；
- 具备迟滞功能，强力抗干扰。

## 2.18 嵌入式调试系统

嵌入式调试解决方案，提供全功能的实时调试器，配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。支持 4 个硬断点以及多个软断点。

## 2.19 编程模式

支持两种编程模式：在线编程、离线编程。

支持两种编程协议：ISP 协议、SWD 协议。

支持统一编程接口：ISP 协议与 SWD 协议共用 SWD 端口。

## 2.20 器件电子签名

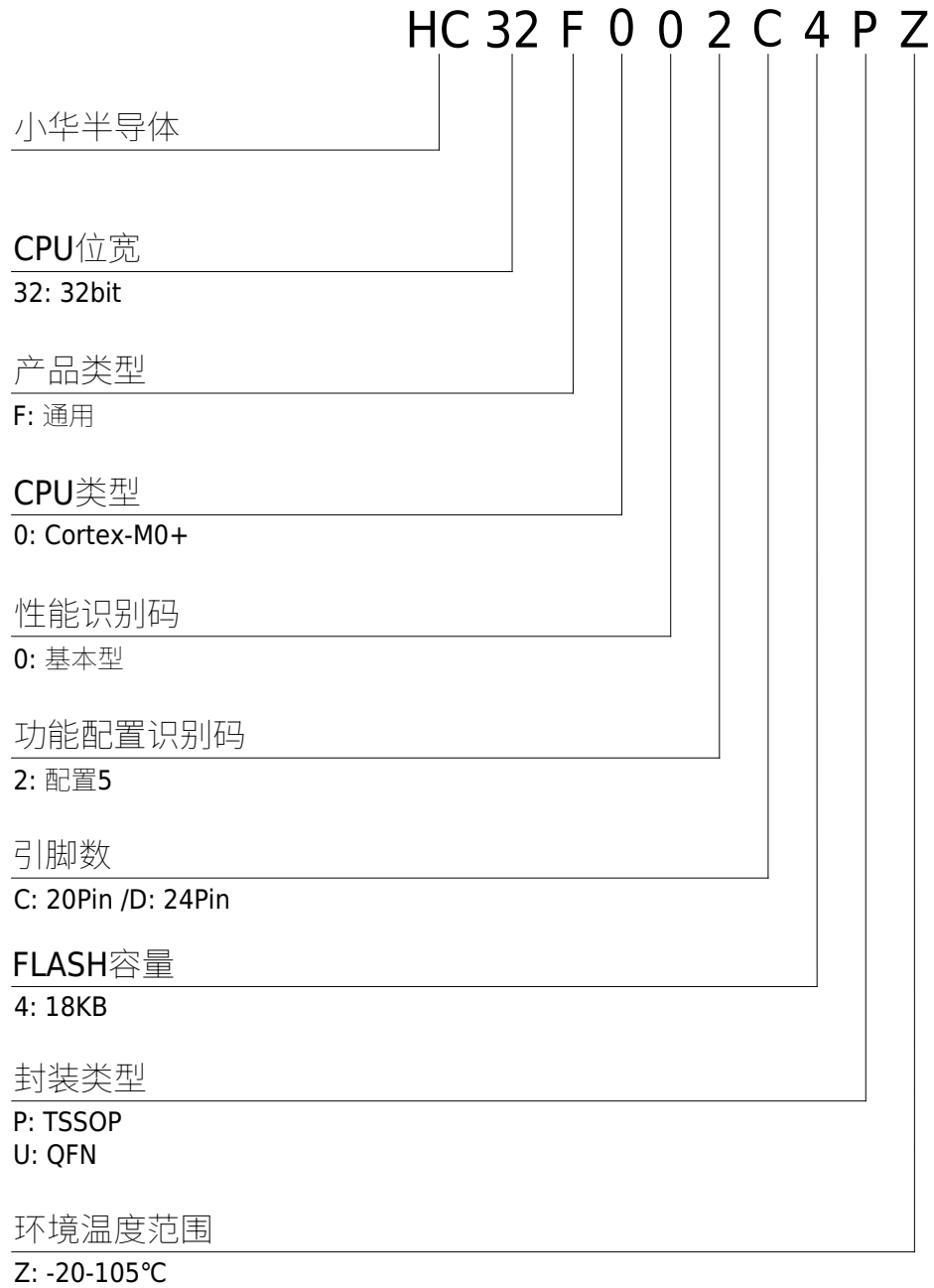
每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号，包括 wafer lot 信息，以及芯片坐标信息等。内建 128 字节 OTP，仅可通过编程器写入一次。

## 2.21 高安全性

加密型嵌入式调试解决方案，提供全功能的实时调试器。

### 3 产品阵容

#### 3.1 产品名称



### 3.2 功能

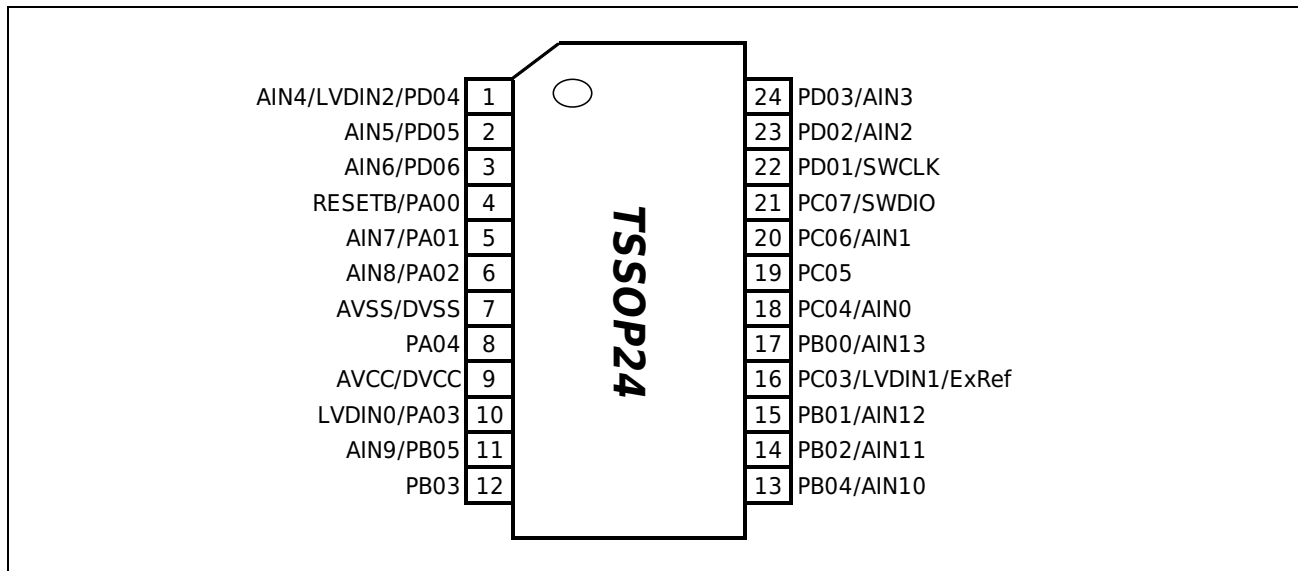
产品名称		HC32F002C4PZ	HC32F002C4UZ	HC32F002D4PZ	HC32F002D4UZ
引脚数		20	20	24	24
GPIO 引脚数		18	18	22	22
CPU	内核	Cortex M0+			
	频率	48MHz			
电源电压范围		1.7 ~ 5.5V			
温度范围		-20 ~ 105°C			
调试功能		SWD 调试接口			
唯一识别码		支持			
通信接口		LPUART0/1 SPI I2C			
定时器		高级定时器 ATIM3 通用定时器 GTIM 或 BTIM3/4/5 低功耗定时器 CTRIM			
10 位 A/D 转换器		14ch+1ch(内部)			
端口中断		18	18	22	22
低电压检测复位		1			
时钟	内部高速振荡器	RCH 44.24/48MHz			
	内部低速振荡器	RCL 32.8/38.4kHz			
蜂鸣器		Max 4ch			
Flash 安全保护		支持			



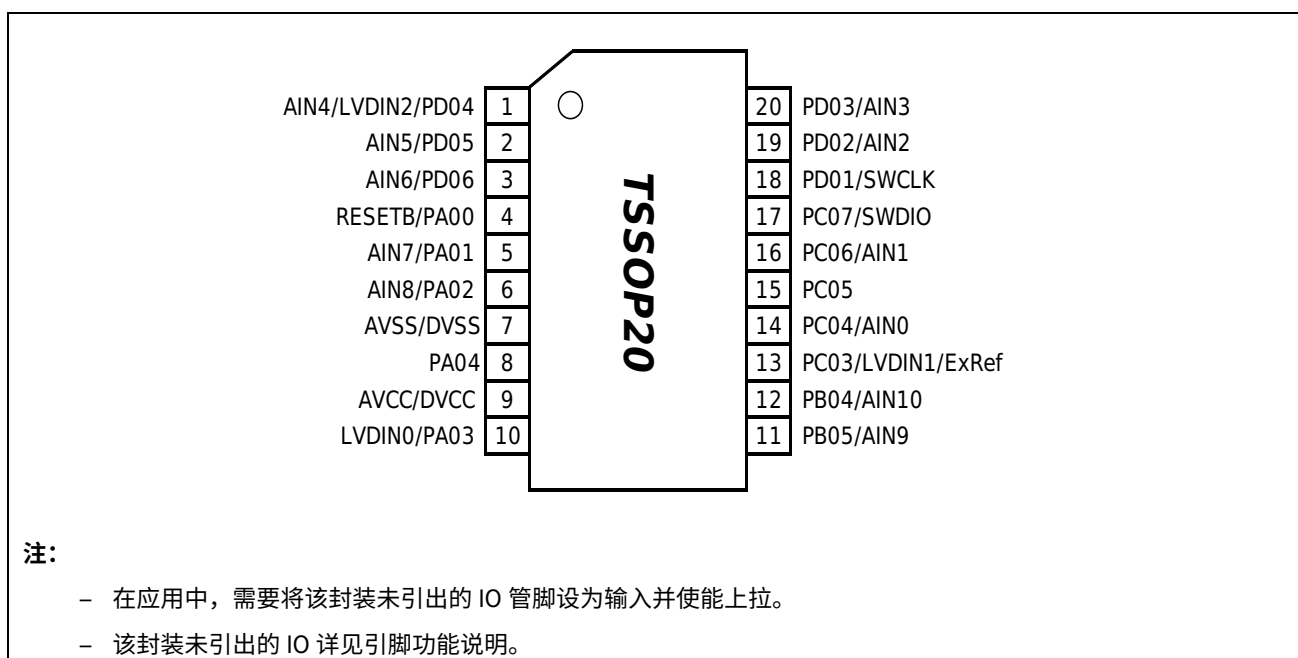
## 4 引脚配置及功能

### 4.1 引脚配置图

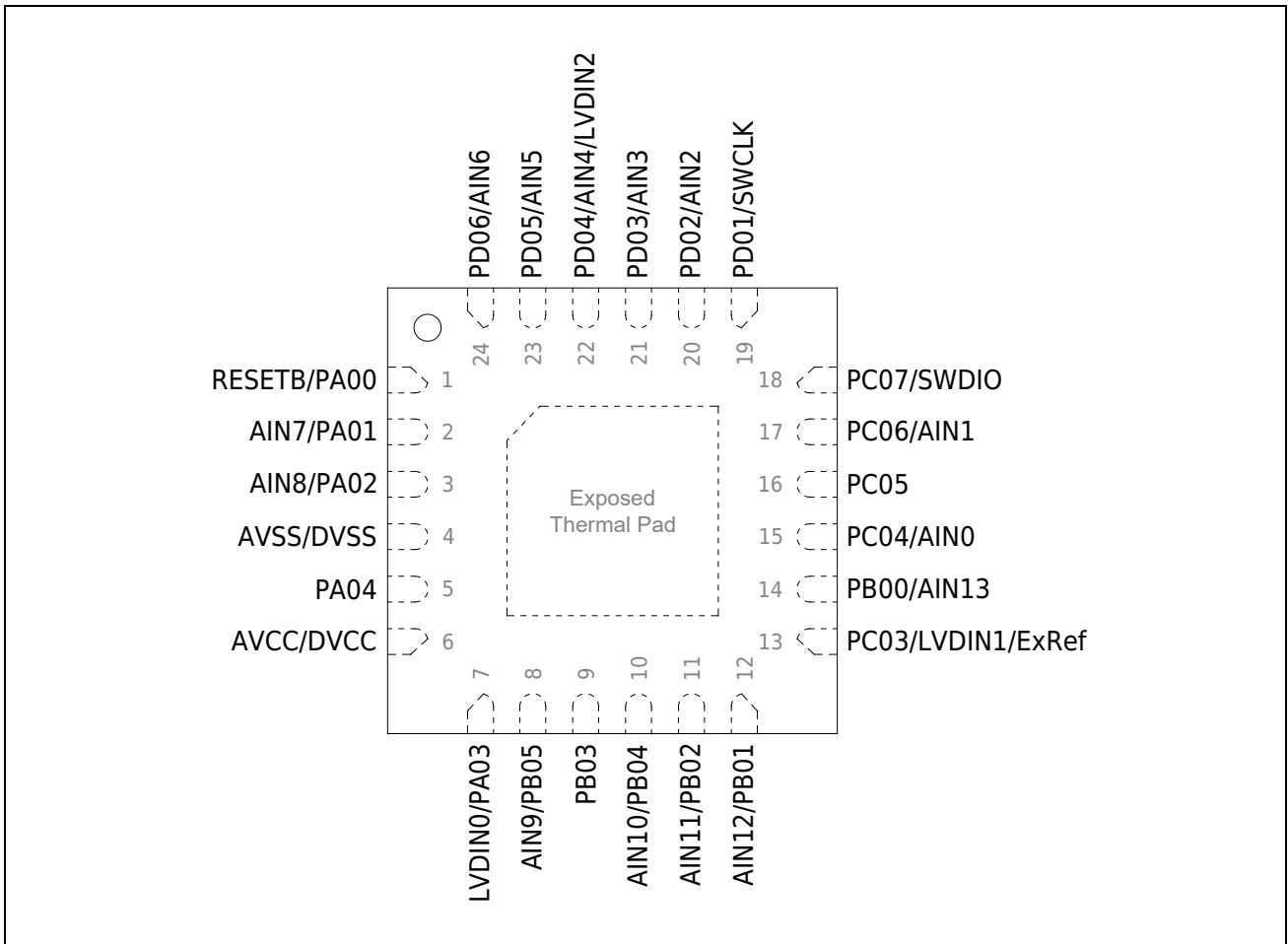
**HC32F002D4PZ-TSSOP24/ HC32F002D4PZ-TSSOP24TR**



**HC32F002C4PZ-TSSOP20/ HC32F002C4PZ-TSSOP20TR**



**HC32F002D4UZ-QFN24TR**



HC32F002C4UZ-ZFN20TR

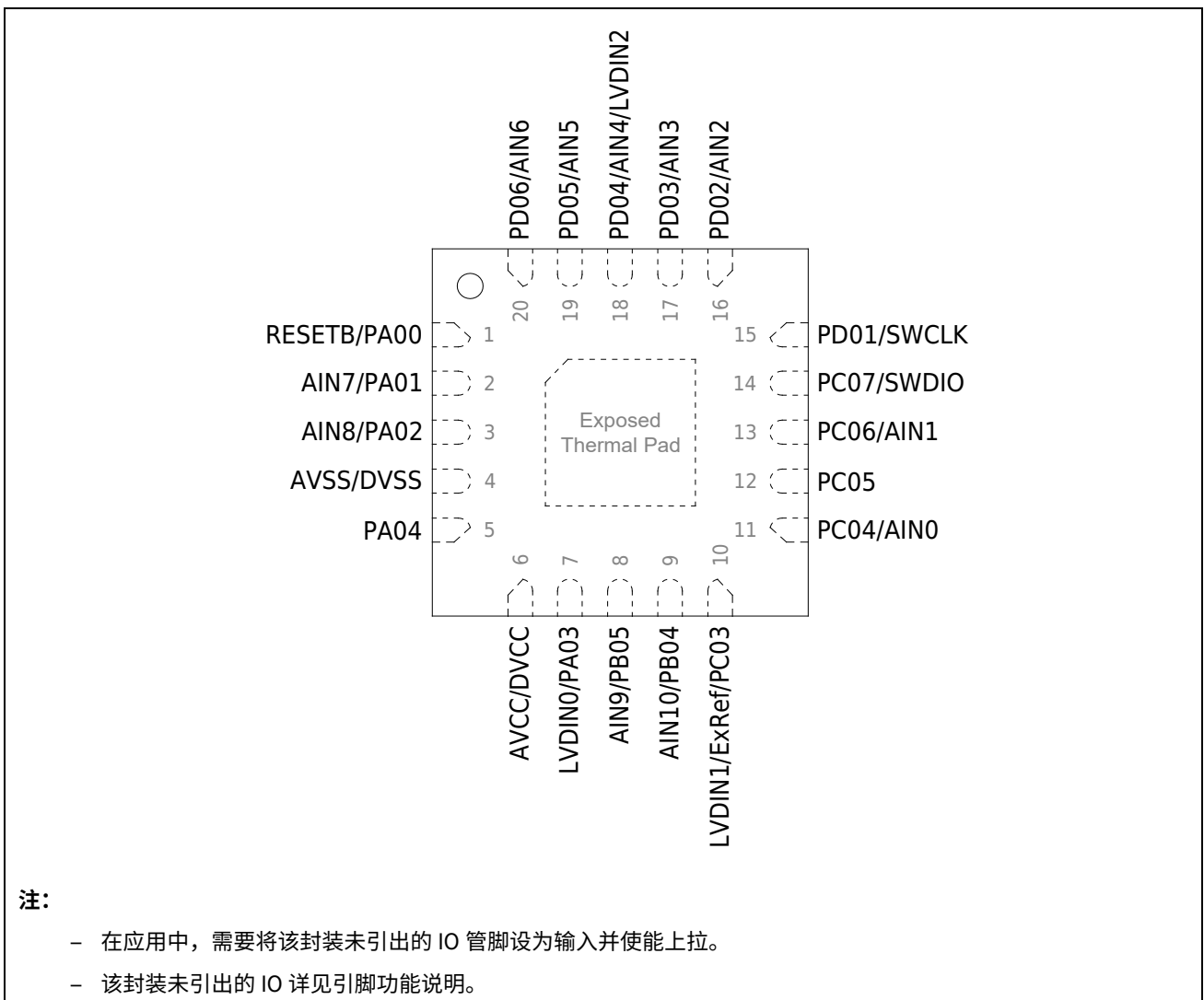


图 4-1 引脚配置图

## 4.2 引脚功能说明

QFN20	QFN24	TSSOP20	TSSOP24	NAME	DIGITAL	ANALOG
1	1	4	4	PA00	-	RESETB
2	2	5	5	PA01	LPUART0_RXD I2C_SDA GTIM_TOGP HCLK_OUT	ADC_AIN7 EXTCLK
3	3	6	6	PA02	LPUART0_TXD I2C_SCL GTIM_TOGN LVD_OUT	ADC_AIN8
4	4	7	7	AVSS/DVSS		
5	5	8	8	PA04	GTIM_TOGP LVD_OUT SPI_NSS	-
6	6	9	9	AVCC/DVCC		
7	7	10	10	PA03	GTIM_CH2 SPI_NSS CTRM_ETR CTIRM_TOG	LVD_IN0
8	8	11	11	PB05	I2C_SDA ATIM3_BK CTRM_ETR CTIRM_TOG	ADC_AIN9
	9		12	PB03	ATIM3_ETR GTIM_CH0 LPUART1_CTS	-
9	10	12	13	PB04	I2C_SCL ATIM3_CH2B LPUART0_CTS	ADC_AIN10
	11		14	PB02	ATIM3_CH2B GTIM_CH1 LPUART1_RTS	ADC_AIN11
	12		15	PB01	ATIM3_CH1B GTIM_CH2 LPUART0_CTS	ADC_AIN12
10	13	13	16	PC03	ATIM3_CH2A ATIM3_CH0B LPUART0_RTS	LVD_IN1 ADC_ExRef
	14		17	PB00	ATIM3_CH0B GTIM_CH3 LPUART0_RTS	ADC_AIN13
11	15	14	18	PC04	ATIM3_CH0B ATIM3_CH1B TCLK_OUT	ADC_AIN0
12	16	15	19	PC05	SPI_SCK GTIM_CH3 ATIM3_ETR	-
13	17	16	20	PC06	SPI_MOSI ATIM3_CH0A LPUART1_RTS	ADC_AIN1
14	18	17	21	PC07 SWDIO	SPI_MISO ATIM3_CH1A LPUART0_RXD	-
15	19	18	22	PD01 SWCLK	GTIM_ETR ATIM3_BK LPUART0_TXD	-
16	20	19	23	PD02	GTIM_CH2 ATIM3_CH2A LPUART1_CTS	ADC_AIN2

QFN20	QFN24	TSSOP20	TSSOP24	NAME	DIGITAL	ANALOG
17	21	20	24	PD03	GTIM_CH1 ATIM3_CH1A LPUART1_RXD	ADC_AIN3
18	22	1	1	PD04	GTIM_CH0 LPUART1_TXD SPI_SCK	ADC_AIN4 LVD_IN2
19	23	2	2	PD05	LPUART1_TXD ATIM3_CH0A SPI_MISO	ADC_AIN5
20	24	3	3	PD06	LPUART1_RXD GTIM_ETR SPI_MOSI	ADC_AIN6

每个管脚的数字功能由 AFRx 寄存器进行控制，详见 GPIO 章节。

### 4.3 模块信号说明

表 4-1 模块信号说明

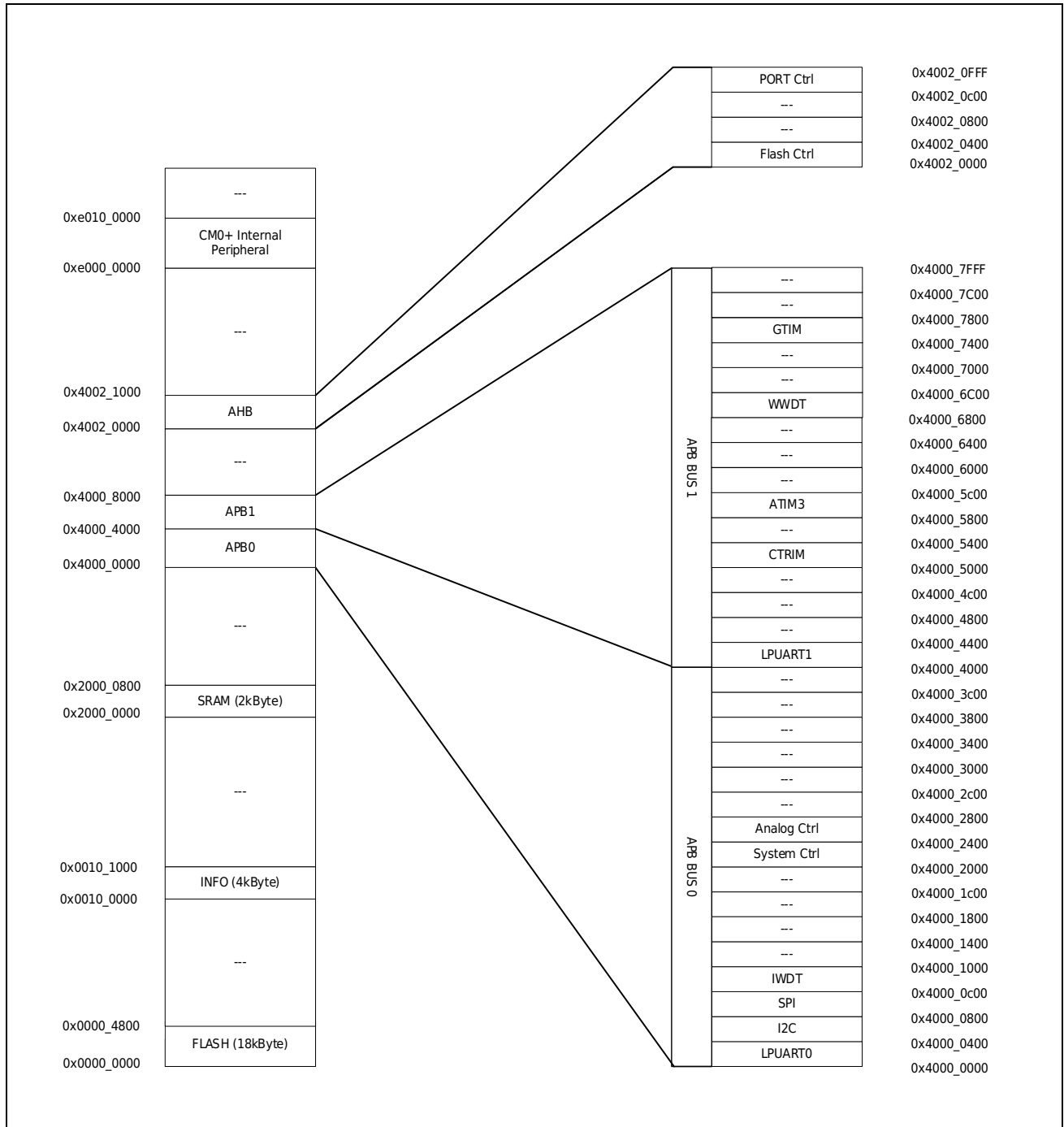
模块	管脚名称	描述
电源	DVCC	数字电源
	AVCC	模拟电源
	DVSS	数字地
	AVSS	模拟地
ADC	ADC_AIN0~13	ADC 输入通道 0~13
	ADC_ExRef	ADC 外部参考电压
外灌时钟	EXTCLK	外部输入时钟
LVD	LVD_IN0	电压侦测输入 0
	LVD_IN1	电压侦测输入 1
	LVD_IN2	电压侦测输入 2
	LVD_OUT	电压侦测输出
LPUART x=0,1	LPUARTx_TXD	LPUART 数据发送端
	LPUARTx_RXD	LPUART 数据接收端
	LPUARTx_CTS	LPUART CTS
	LPUARTx_RTS	LPUART RTS
CTRIM	CTRIM_ETR	CTRIM 外部同步信号
	CTRIM_TOG	CTRIM 的翻转输出信号
SPI	SPI_MISO	SPI 模块主机输入从机输出数据信号
	SPI_MOSI	SPI 模块主机输出从机输入数据信号
	SPI_SCK	SPI 模块时钟信号
	SPI_NSS	SPI 片选
I2C	I2C_SDA	I2C 模块数据信号
	I2C_SCL	I2C 模块时钟信号
基本定时器 BTIMx x = 3,4,5	BTIMx_TOGP	BTIMx 的翻转输出信号
	BTIMx_TOGN	

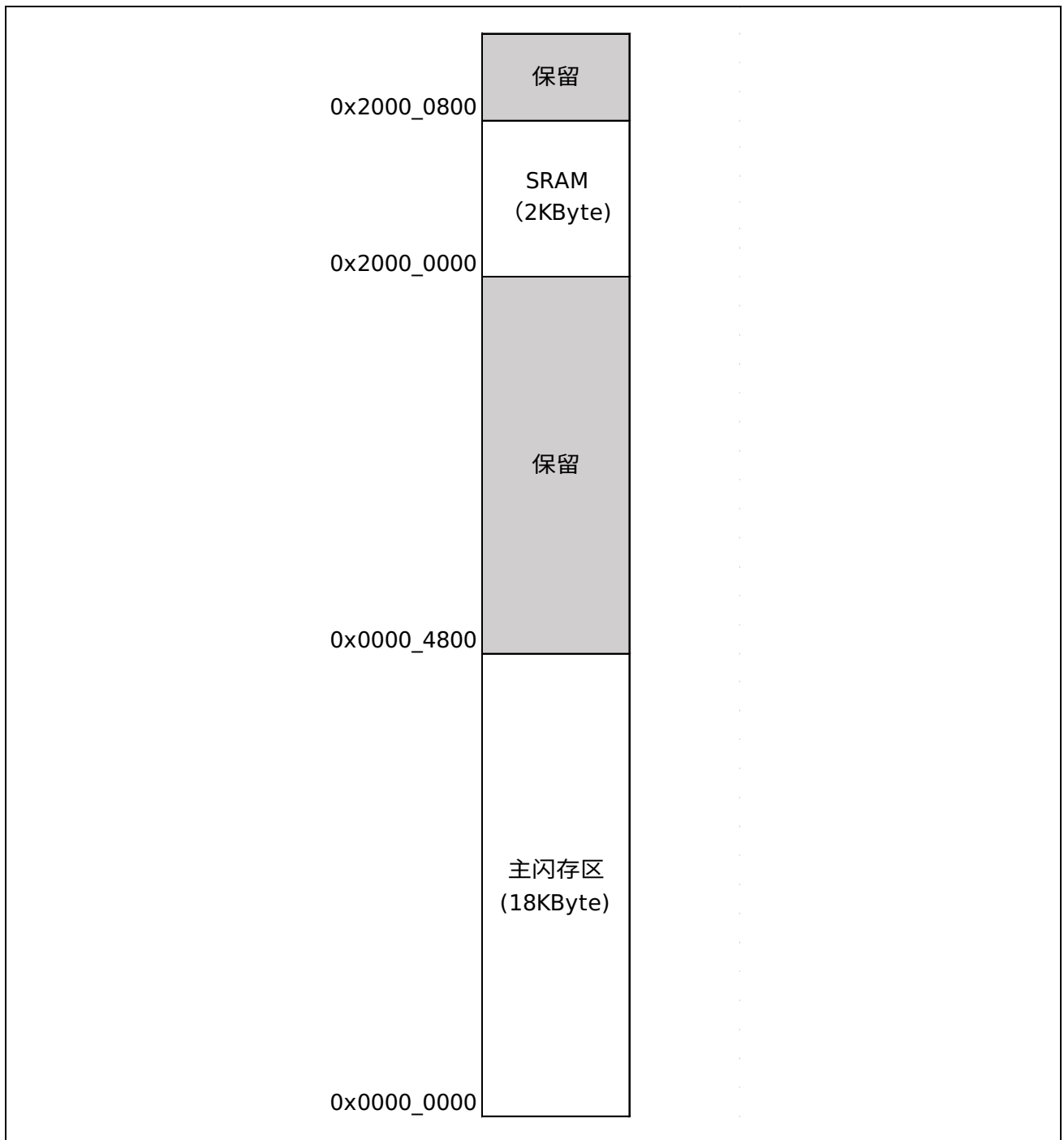
模块	管脚名称	描述
通用定时器 GTIM y=0,1,2,3	GTIM_CHy	GTIM 的捕获输入比较输出
	GTIM_ETR	GTIM 的外部计数输入信号
	GTIM_TOGP GTIM_TOGN	GTIM 的翻转输出信号
高级定时器 ATIM3 y=0,1,2	ATIM3_CHyA	ATIM3 的捕获输入比较输出 A
	ATIM3_CHyB	ATIM3 的捕获输入比较输出 B
	ATIM3_ETR	ATIM3 的外部计数输入信号
	ATIM3_BK	ATIM3 的刹车信号

**注意：**

- IO 端口复位为输入高阻状态，休眠模式和深度休眠模式保持之前的端口状态。

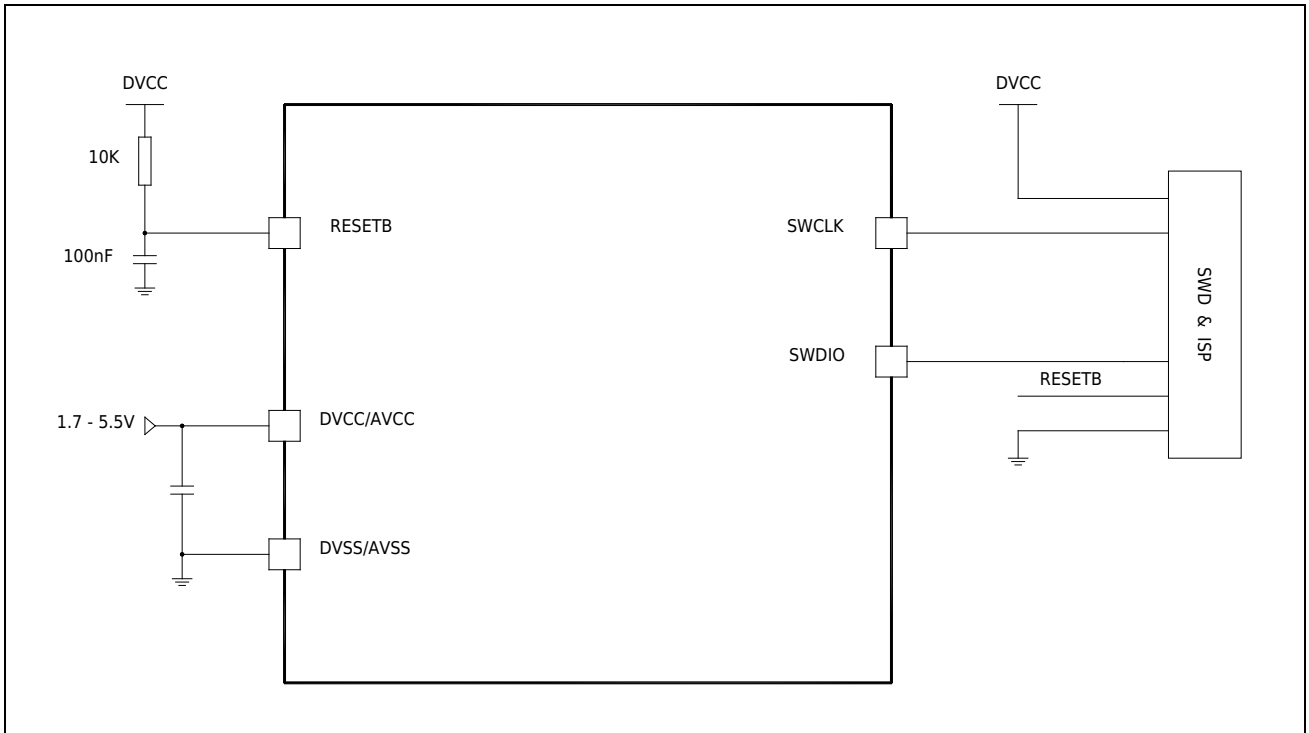
## 5 存储区映射图







## 6 典型应用电路图



### 注意：

- 电源需要一个去耦电容，去耦电容尽量靠近相应电源管脚。

## 7 电气特性

### 7.1 测试条件

除非特别说明，所有电压的都以 VSS 为基准。

#### 7.1.1 最小和最大数值

除非特别说明,在生产线上通过对 100%的产品在环境温度  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  和  $T_A=T_{A\max}$  下执行的测试( $T_{A\max}$  与选定的温度范围匹配),所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。

在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\sigma$ )得到。

#### 7.1.2 典型数值

除非特别说明,典型数据是基于  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  和  $V_{CC}=3.3\text{V}$ 。这些数据仅用于设计指导而未经测试。典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品的误差小于等于给出的数值(平均 $\pm 2\sigma$ )。

## 7.2 绝对最大额定值

加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值，可能会导致器件永久性地损坏。这里只是给出能承受的最大载荷，并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值条件下会影响器件的可靠性。

表 7-1 电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC - VSS	外部主供电电压(包含 AVCC 和 DVCC) <sup>(1)</sup>	-0.3	5.5	V
V <sub>IN</sub>	在其它引脚上的输入电压 <sup>(2)</sup>	VSS - 0.3	VCC + 0.3	V
ΔVCC <sub>x</sub>	不同供电引脚之间的电压差		50	mV
VSS <sub>x</sub> - VSS	不同接地引脚之间的电压差		50	mV
V <sub>ESD</sub> (HBM)	ESD 静电放电电压(人体模型)	参考绝对最大值电气参数		V

1. 所有的电源(DVCC,AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. I<sub>INJ</sub>(PIN)绝对不可以超过它的极限，即保证 V<sub>IN</sub> 不超过其最大值。如果不能保证 V<sub>IN</sub> 不超过其最大值，也要保证在外部限制 I<sub>INJ</sub>(PIN)不超过其最大值。当 V<sub>IN</sub>>VCC 时，有一个正向注入电流；当 V<sub>IN</sub><VSS 时，有一个反向注入电流。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值 <sup>(1)</sup>	单位
I <sub>VCC</sub>	经过 DVCC/AVCC 电源线的总电流(供应电流) <sup>(1)</sup>	300	mA
I <sub>VSS</sub>	经过 VSS 地线的总电流(流出电流) <sup>(1)</sup>	300	mA
I <sub>IO</sub>	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	25	mA
	任意 I/O 和控制引脚上的输出电流	-25	mA
I <sub>INJ</sub> (PIN) <sup>(2) (3)</sup>	RESETB 引脚的注入电流	+/-5	mA
	其他引脚的注入电流 <sup>(4)</sup>	+/-5	mA
∑I <sub>INJ</sub> (PIN) <sup>(2)</sup>	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 <sup>(4)</sup>	+/-25	mA

1. 所有的电源(DVCC,AVCC)和地(DVSS,AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. I<sub>INJ</sub>(PIN)绝对不可以超过它的极限，即保证 V<sub>IN</sub> 不超过其最大值。如果不能保证 V<sub>IN</sub> 不超过其最大值，也要保证在外部限制 I<sub>INJ</sub>(PIN)不超过其最大值。当 V<sub>IN</sub>>VCC 时，有一个正向注入电流；当 V<sub>IN</sub><VSS 时，有一个反向注入电流。
3. 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。
4. 当几个 I/O 口同时有注入电流时，∑I<sub>INJ</sub>(PIN)的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。该结果基于在器件 4 个 I/O 端口上∑I<sub>INJ</sub>(PIN)最大值的特性。

表 7-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
TSTG	储存温度范围	-60 ~ + 150	°C
T <sub>J</sub>	最大结温度	125	°C

## 7.3 工作条件

### 7.3.1 通用工作条件

表 7-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f <sub>HCLK</sub>	内部 AHB 时钟频率		0	48	MHz
f <sub>PCLK0</sub>	内部 APB0 时钟频率		0	48	MHz
f <sub>PCLK1</sub>	内部 APB1 时钟频率		0	48	MHz
DVCC	数字部分工作电压		1.7	5.5	V
AVCC <sup>(1)</sup>	模拟部分工作电压	必须与 DVCC <sup>(2)</sup> 相同	1.7	5.5	V
PD	功率耗散 TA=105°C	TSSOP20		283	mW
	功率耗散 TA=105°C	TSSOP24		291	mW
TA	环境温度	最大功率消耗	-20	105	°C
		低功率消耗 <sup>(3)</sup>	-20	125	°C
T <sub>J</sub>	结温度范围		-20	125	°C

1. 当使用 ADC 时，参见 ADC 电气参数。
2. 建议使用相同的电源为 DVCC 和 AVCC 供电，在上电和正常操作期间，DVCC 和 AVCC 之间最多允许有 300mV 的差别。
3. 在较低的功率耗散的状态下，只要 T<sub>J</sub> 不超过 T<sub>Jmax</sub>，T<sub>A</sub> 可以扩展到这个范围。

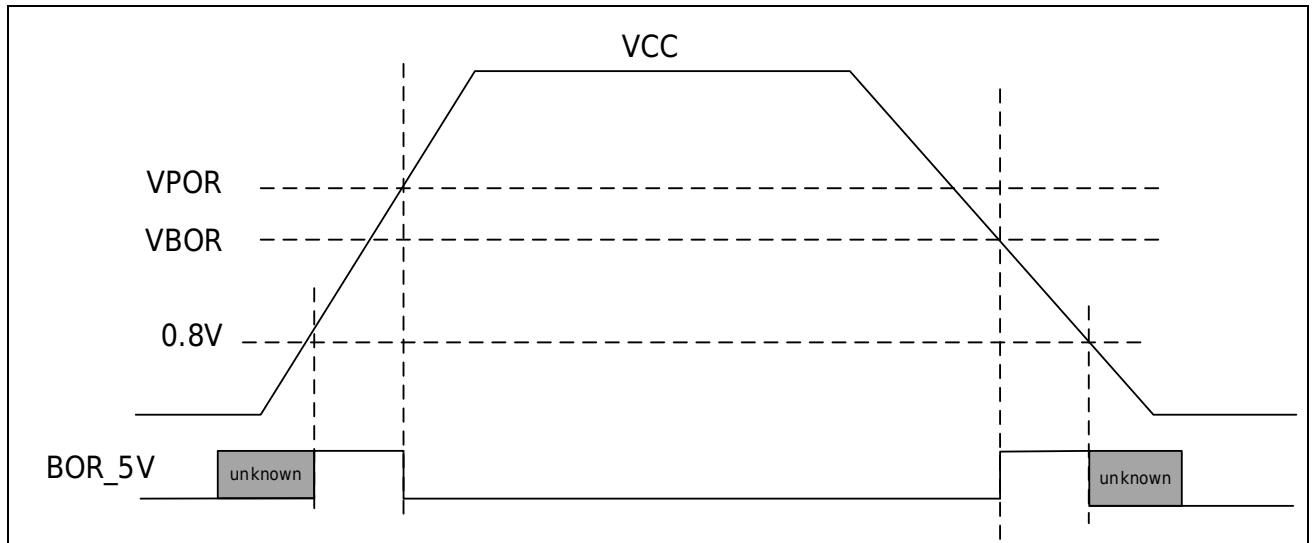
### 7.3.2 上电和掉电时的工作条件

表 7-5 上电和掉电的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>VCC</sub>	VCC 上升速率		0.2	20000	μs/V
t <sub>VCC</sub>	VCC 下降速率		0.2	20000	μs/V

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试

### 7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性



1. 设计保证，不在生产中测试。

图 7-1 POR/Brown Out 示意图

表 7-6 POR/Brown Out

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vpor	POR 释放电压 (上电过程)			1.65	1.7	V
Vbor	BOR 检测电压 (掉电过程)			1.55		V

表 7-7 LVD 模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vex	外部输入电压范围		0		VCC	V
Vlevel	检测阈值	LVD_CR.VTDS=0000 LVD_CR.VTDS=0001 LVD_CR.VTDS=0010 LVD_CR.VTDS=0011 LVD_CR.VTDS=0100 LVD_CR.VTDS=0101 LVD_CR.VTDS=0110 LVD_CR.VTDS=0111 LVD_CR.VTDS=1000 LVD_CR.VTDS=1001 LVD_CR.VTDS=1010 LVD_CR.VTDS=1011 LVD_CR.VTDS=1100 LVD_CR.VTDS=1101 LVD_CR.VTDS=1110 LVD_CR.VTDS=1111		1.8±3.5% 1.9±3.5% 2.0±3.5% 2.1±3.5% 2.2±3.5% 2.3±3.5% 2.4±3.5% 2.5±3.5% 2.6±3.5% 2.7±3.5% 2.8±3.5% 2.9±3.5% 3.0±3.5% 3.1±3.5% 3.2±3.5% 3.3±3.5%		V
Icomp	功耗			0.36		uA
Tresponse	响应时间			100		μs
Tsetup	建立时间			300		μs
Vhyste	迟滞电压			40		mV
Tfilter	滤波时间	LVD_CR.FltTime = 000 LVD_CR.FltTime = 001 LVD_CR.FltTime = 010 LVD_CR.FltTime = 011 LVD_CR.FltTime = 100 LVD_CR.FltTime = 101 LVD_CR.FltTime = 110 LVD_CR.FltTime = 111	25 75 175 375 1575 6375 25575 102375	50 100 200 400 1600 6400 25600 102400		μs

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试。

### 7.3.4 内置的参考电压 BGR

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>BGR09</sub>	Internal 0.9V Reference Voltage	常温 25°C; 3.3V		0.9		V
V <sub>BGR09</sub>	Internal 0.9V Reference Voltage	-20~105°C; 1.7~5.5V	0.875		0.925	V
T <sub>Coeff</sub>	Internal 0.9V temperature coefficient	-20~105°C		50		ppm/°C

1. 数据基于考核结果，不在生产中测试

### 7.3.5 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。

微控制器处于下列条件：

- 所有的 I/O 引脚都处于输入模式，并连接到 VCC 或 VSS(无负载)。
- 所有的外设都处于关闭状态，除非特别说明。
- 闪存存储器的访问时间调整到 f<sub>HCLK</sub> 的频率(0~24MHz 时为 0 个等待周期，24~48MHz 时为 1 个等待周期)。
- 当开启外设时：f<sub>PCLK0</sub> = f<sub>HCLK</sub>，f<sub>PCLK1</sub> = f<sub>HCLK</sub>。

表 7-8 工作电流特性

Symbol	Parameter	Conditions		Typ <sup>(1)</sup>	Max <sup>(2)</sup>	Unit	
IDD (Run in RAM)	All peripherals clock ON, Run while(1) in RAM	VCC=3.3V TA=25°C	RCH clock source	4M	505	uA	
				8M	730		
				12M	955		
				22.12M	1515		
				24M	1630		
				44.24M	2755		
				48M	2980		
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in RAM	VCC=3.3V TA=25°C	RCH clock source	4M	410	uA	
				8M	545		
				12M	680		
				22.12M	1005		
				24M	1080		
				44.24M	1735		
				48M	1870		
IDD (Run mode)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	VCC=1.7~5.5V TA=-20~105°C	RCH clock source	4M	725	870	uA
				8M	1160	1350	
				12M	1575	1820	
				22.12M	2545	2960	

Symbol	Parameter	Conditions		Typ <sup>(1)</sup>	Max <sup>(2)</sup>	Unit
				24M	2735	3170
				44.24M FlashWait=1	3515	4070
				48M FlashWait=1	3790	4380
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	VCC=1.7~5.5V TA=-20~105°C	RCH clock source	4M	635	770
				8M	970	1140
				12M	1295	1510
				22.12M	2035	2390
				24M	2185	2550
				44.24M FlashWait=1	2500	2930
				48M FlashWait=1	2685	2950
IDD (Sleep mode)	All peripherals clock ON	VCC=1.7~5.5V TA=-20~105°C	RCH clock source	4M	400	470
				8M	520	610
				12M	635	740
				22.12M	925	1070
				24M	990	1140
				44.24M FlashWait=1	1570	1800
				48M FlashWait=1	1695	1930
	All peripherals clock OFF	VCC=1.7~5.5V TA=-20~105°C	RCH clock source	4M	305	370
				8M	335	400
				12M	360	430
				22.12M	415	490
				24M	435	520
				44.24M FlashWait=1	550	640
				48M FlashWait=1	585	680
IDD (LP Run)	All peripherals clock ON, Run while(1) in Flash	VCC=1.7~5.5V	RCL32K clock source	TA=-20~25°C	7.4	14.4
				TA=50°C	7.9	14.9
				TA=85°C	9.3	16.0
				TA=105°C	11.4	22.0
	All peripherals clock OFF, Run while(1) in Flash	VCC=1.7~5.5V	RCL32K clock source	TA=-20~25°C	6.7	12.8
				TA=50°C	7.2	13.6
				TA=85°C	8.5	14.9
				TA=105°C	10.6	21.0
IDD (LP Sleep)	All peripherals clock ON	VCC=1.7~5.5V	RCL32K clock source	TA=-20~25°C	4.4	10.3
				TA=50°C	4.8	10.7
				TA=85°C	6.1	11.2
				TA=105°C	8.1	18.8



Symbol	Parameter	Conditions		Typ <sup>(1)</sup>	Max <sup>(2)</sup>	Unit		
	All peripherals clock OFF	VCC=1.7~5.5V	RCL32K clock source	TA=-20~25°C	3.7	7.3	uA	
				TA=50°C	4.0	7.8		
				TA=85°C	5.3	10.5		
				TA=105°C	7.4	18.3		
IDD (DeepSleep mode)	WDT+LVD+RCL32K+DeepSleep	VCC=1.7~5.5V		TA=-20~25°C	3.2	6.9	uA	
				TA=50°C	3.7	7.5		
				TA=85°C	4.9	9.2		
				TA=105°C	6.7	14.6		
	LVD+RCL32K+DeepSleep	VCC=1.7~5.5V			TA=-20~25°C	2.6	6.2	uA
					TA=50°C	3.0	6.7	
					TA=85°C	4.0	8.7	
					TA=105°C	5.5	13	
	WDT+RCL32K+DeepSleep	VCC=1.7~5.5V			TA=-20~25°C	3.0	6.5	uA
					TA=50°C	3.4	7.0	
					TA=85°C	4.6	8.8	
					TA=105°C	6.3	14.0	
	RCL38K+DeepSleep	VCC=1.7~5.5V			TA=-20~25°C	3.0	6.5	uA
					TA=50°C	3.4	7.0	
					TA=85°C	4.6	8.8	
					TA=105°C	6.3	14.0	
RCL32K+DeepSleep	VCC=1.7~5.5V			TA=-20~25°C	3.0	6.5	uA	
				TA=50°C	3.4	7.0		
				TA=85°C	4.6	8.8		
				TA=105°C	6.3	14.0		
DeepSleep	VCC=1.7~5.5V			TA=-20~25°C	2.4	5.8	uA	
				TA=50°C	2.7	6.3		
				TA=85°C	3.8	8.2		
				TA=105°C	5.2	12.5		

1. 若没有其他指定条件，该 Typ 的值是在 25°C & V<sub>CC</sub> = 3.3V 测得。
2. 若没有其他指定条件，该 Max 的值是 V<sub>CC</sub> = 1.7-5.5V & Temperature = -20 ~ 105°C范围内的最大值。
3. 数据基于考核结果，不在生产中测试

### 7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间

唤醒时间是在 RCH 振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定：

- 休眠模式：时钟源是 RCH 振荡器
- 深度休眠模式：时钟源是进入深度休眠时所使用的时钟是 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
T <sub>wu</sub>	休眠模式唤醒时间			2.0		μs
	深度休眠唤醒时间	F <sub>HCLK</sub> = 4 ~ 48MHz		5.0		μs

1. 唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令。

### 7.3.7 外部时钟源特性

#### 7.3.7.1 外部输入高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f <sub>EXT</sub>	用户外部时钟频率 <sup>(1)</sup>		1	8	16	MHz
V <sub>EXTH</sub>	输入引脚高电平电压		0.7VCC		VCC	V
V <sub>EXTL</sub>	输入引脚低电平电压		VSS		0.3VCC	V
T <sub>rEXT</sub>	上升的时间 <sup>(1)</sup>				20	ns
T <sub>fEXT</sub>	下降的时间 <sup>(1)</sup>				20	ns
T <sub>wEXT</sub>	输入高或低的时间 <sup>(1)</sup>		16			ns
C <sub>inEXT</sub>	输入容抗 <sup>(1)</sup>			5		pF
Duty	占空比		40		60	%
IL	输入漏电流				±1	μA

1. 由设计保证，不在生产中测试。

### 7.3.8 内部时钟源特性

#### 7.3.8.1 内部 RCH 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCH 振荡器精度	User trimming step for given VCC and TA conditions		0.25		%
		VCC = 1.7 ~ 5.5V T <sub>AMB</sub> = -20 ~ 105°C	-3.5		+3.5	%
		VCC = 1.7 ~ 5.5V T <sub>AMB</sub> = -20 ~ 50°C	-2		+2	%
F <sub>CLK</sub>	振荡频率		40.0		48.0	MHz
I <sub>CLK</sub>	功耗	F <sub>MCLK</sub> = 48MHz		170		μA
DC <sub>CLK</sub>	占空比 <sup>(1)</sup>		45	50	55	%

1. 由综合评估得出，不在生产中全部测试。

#### 7.3.8.2 内部 RCL 振荡器

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Dev	RCL 振荡器精度	User trimming step for given VCC and TA conditions		0.5		%
		VCC = 1.7 ~ 5.5V T <sub>AMB</sub> = -20 ~ 105°C	-5		+5	%
		VCC = 1.7 ~ 5.5V T <sub>AMB</sub> = -20 ~ 50°C	-3		+3	%
F <sub>CLK</sub>	振荡频率			38.4 32.8		KHz
T <sub>CLK</sub>	启动时间			150		μs
DC <sub>CLK</sub>	占空比 <sup>(1)</sup>		25	50	75	%
I <sub>CLK</sub>	功耗			1.5		μA

1. 由综合评估得出，不在生产中全部测试。

### 7.3.9 存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
EC <sub>FLASH</sub> <sup>(1)</sup>	擦写次数	T <sub>AMB</sub> = 25°C	20			kcycles
RET <sub>FLASH</sub> <sup>(1)</sup>	数据保存期限	T <sub>AMB</sub> = 85°C, after 20 kcycles	20			Years
T <sub>b_prog</sub> <sup>(2)</sup>	编程时间 (字节)		22		30	μs
T <sub>w_prog</sub> <sup>(2)</sup>	编程时间 (字)		40		52	μs
T <sub>p_erase</sub> <sup>(2)</sup>	页擦除时间		4		5	ms
T <sub>m_erase</sub> <sup>(2)</sup>	整片擦除时间		30		40	ms

1. 数据由考核保证，不在生产中测试。
2. 数据由设计保证，不在生产中测试。

### 7.3.10 EFT 特性

芯片复位可以使系统恢复正常操作。

符号	级别/类型
EFT to IO (IEC61000-4-4)	Class: 4A
EFT to Power (IEC61000-4-4)	Class: 4A

1. 数据由考核保证，不在生产中测试

#### 软件建议

软件的流程中必须包含应对程序跑飞的控制，如：

- 被破坏的程序计数器
- 意外的复位
- 关键数据被破坏（控制寄存器等）

在进行 EFT 测试时，可以把超出应用要求的干扰直接施加在芯片电源或 IO 上，当检测到意外动作的地方，软件部分进行加强以防止发生不可恢复的错误。

### 7.3.11 ESD 特性

使用特定的测量方法，对芯片进行强度测试以决定它的电气敏感性方面的性能。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VE <sub>SDHBM</sub>	ESD @ Human Body Mode			4		kV
VE <sub>SDCDM</sub>	ESD @ Charge Device Mode			1		kV
VE <sub>SDMM</sub>	ESD @ machine Mode			200		V
I <sub>latchup</sub>	Latch up current			200		mA

1. 数据由考核保证，不在生产中测试。

### 7.3.12 I/O 端口特性

#### 7.3.12.1 输出特性——端口

表 7-9 端口输出特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V <sub>OH</sub>	High level output voltage Source Current	Sourcing 4 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25		V
		Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)	VCC-0.6		V
V <sub>OL</sub>	Low level output voltage Sink Current	Sinking 5 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.25	V
		Sinking 14 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.6	V
V <sub>OHD</sub>	High level output voltage Double source Current	Sourcing 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)	VCC-0.25		V
		Sourcing 18 mA, VCC = 3.3V (see Note 2)	VCC-0.6		V
V <sub>OLD</sub>	Low level output voltage Double Sink Current	Sinking 8 mA, VCC = 3.3 V (see Note 1)		VSS+0.25	V
		Sinking 18 mA, VCC = 3.3 V (see Note 2)		VSS+0.6	V

**NOTES:**

1. The maximum total current, I<sub>OH</sub>(max) and I<sub>OL</sub>(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.
2. The maximum total current, I<sub>OH</sub>(max) and I<sub>OL</sub>(max), for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop.
3. 对于封装 QFN20/TSSOP20，管脚 PC3/PC4/PB4/PB5 都与其他管脚双管脚封装在一起的，驱动能力相对其他管脚要高。

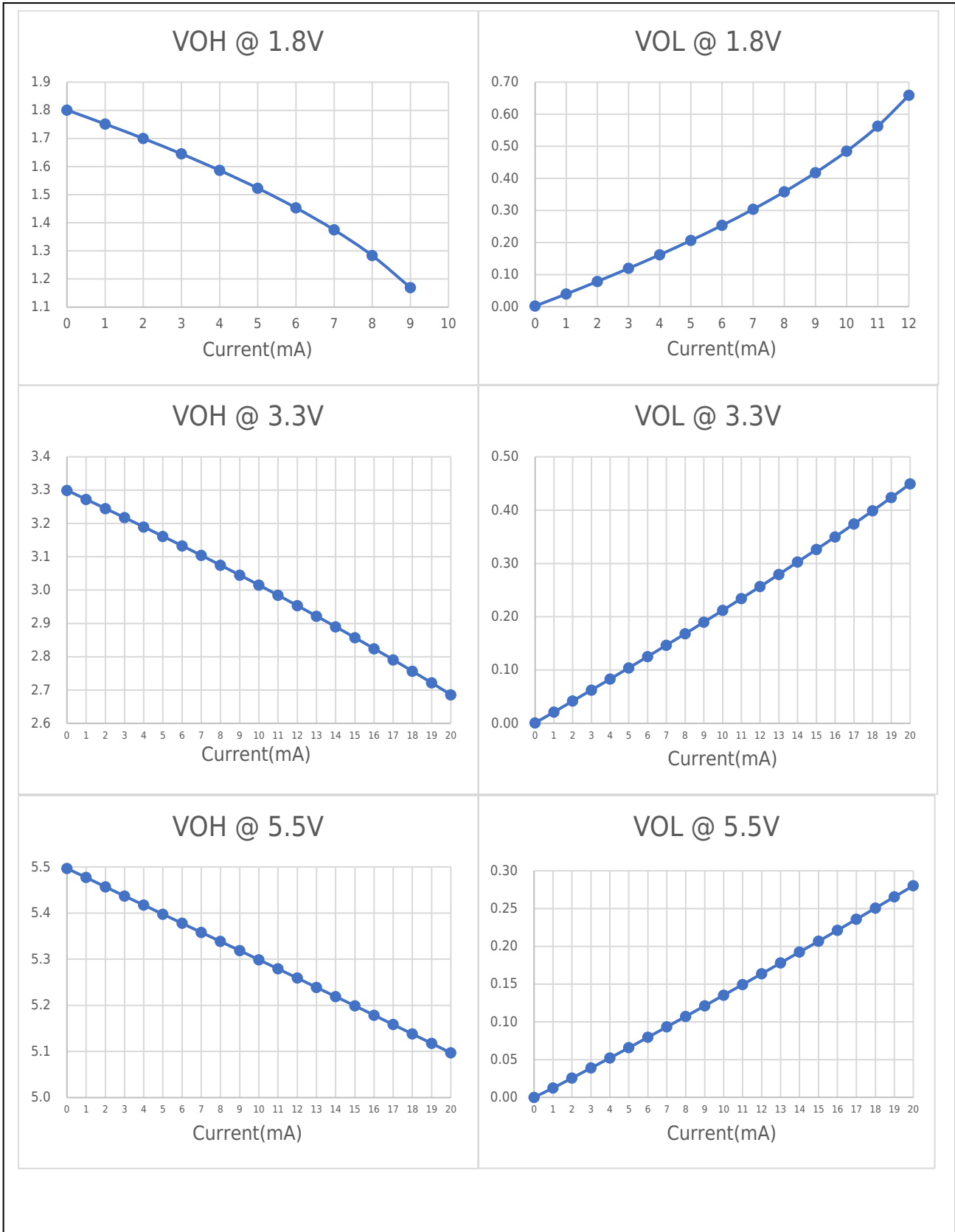


图 7-2 输出端口 VOH/VOL 实测曲线

### 7.3.12.2 输入特性——端口 PA,PB,PC,PD

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>IH</sub>	Positive-going input threshold voltage	VCC=1.8V	0.7VCC			V
		VCC=3.3V	0.7VCC			V
		VCC=5.5V	0.7VCC			V
V <sub>IL</sub>	Negative-going input threshold voltage	VCC=1.8V			0.3VCC	V
		VCC=3.3V			0.3VCC	V
		VCC=5.5V			0.3VCC	V
V <sub>hys(1)</sub>	Input voltage hysteresis (V <sub>IH</sub> - V <sub>IL</sub> )	VCC=1.8V		0.3		V
		VCC=3.3V		0.4		V
		VCC=5.5V		0.6		V
R <sub>pullhigh</sub>	Pullup resistor	Pullup enabled VCC=3.3V		80		kΩ
C <sub>input</sub>	Input capacitance			5		pF

1. 由综合评估得出，不在生产中全部测试。

### 7.3.12.3 端口外部输入采样要求——Timer Clock

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t(int)	External interrupt timing	External trigger signal for the interrupt flag (see Note 1)		30		ns
t(cap)	Timer capture timing	TIMx capture pulse width F <sub>system</sub> = 4MHz		0.5		μs
t(clk)	Timer clock frequency applied to pin	TIMx external clock input F <sub>system</sub> = 4MHz			PCLK/2	MHz

**NOTES:**

1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum t<sub>(int)</sub> parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than t<sub>(int)</sub>.
2. 由综合评估得出，不在生产中测试。

### 7.3.12.4 端口漏电特性——PA,PB,PC,PD

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>lkg(Px.y)</sub>	Leakage current	V <sub>(Px.y)</sub> (see Note 1,2)		±50		nA

**NOTES:**

1. The leakage current is measured with VSS or VCC applied to the corresponding pin(s), unless otherwise noted.
2. The port pin must be selected as input.
3. 在生产测试中保证。

### 7.3.13 RESETB 引脚特性

RESETB 引脚输入驱动使用 CMOS 工艺，它连接了一个不能断开的上拉电阻。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL}(\text{RESETB})$	输入低电平电压		-0.3		0.3VCC	V
$V_{IH}(\text{RESETB})$	输入高电平电压		0.7VCC		VCC+0.3	V
$V_{hys}(\text{RESETB})$	施密特触发器电压迟滞			200		mV
$R_{PU}$	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$		80		k $\Omega$
$V_F(\text{RESETB})$	输入滤波脉冲				3	us
$V_{NF}(\text{RESETB})$	输入非滤波脉冲		20			us

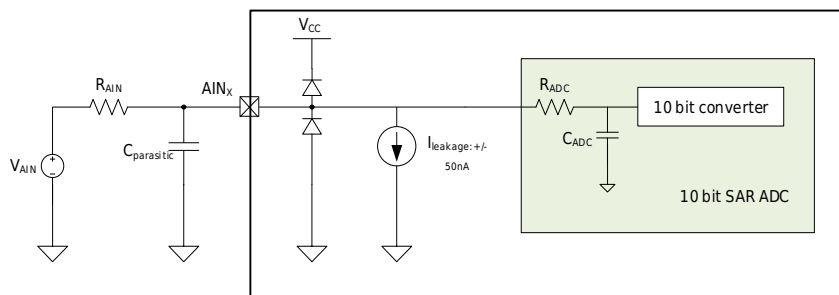
1. 由设计保证，不在生产中测试。



### 7.3.14 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>ADCIN</sub>	Input voltage range	Single ended	0		V <sub>ADCREFIN</sub>	V
V <sub>ADCREFIN</sub>	Input range of external reference voltage	Single ended	0		AVCC	V
I <sub>ADC1</sub>	Active current including reference generator and buffer	200Ksps		0.16		mA
I <sub>ADC2</sub>	Active current without reference generator and buffer	1Msps		0.22		mA
C <sub>ADCIN</sub>	ADC input capacitance			1.6	2	pF
R <sub>ADC</sub> <sup>(1)</sup>	ADC sampling switch impedance			5		kΩ
R <sub>AIN</sub> <sup>(1)</sup>	ADC external input resistor <sup>(2)</sup>				100	kΩ
F <sub>ADCCLK</sub>	ADC clock Frequency				24	MHz
T <sub>ADCSTART</sub>	Startup time of reference generator and ADC core			5		μs
T <sub>ADCCONV</sub>	Conversion time		19	24	25	cycles
ENOB	Effective Bits	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.7V REF=EXREF		9.5		Bit
		1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.7V REF=VCC		9.4		Bit
SNR	Signal to Noise Ratio	1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.7V REF=EXREF		63		dB
		1Msps@VCC>=2.7V 500Ksps@VCC>=2.4V 200Ksps@VCC>=1.7V REF=VCC		63		dB
DNL <sup>(1)</sup>	Differential non-linearity	500Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-1		1	LSB
INL <sup>(1)</sup>	Integral non-linearity	500Ksps; VREF=EXREF/AVCC	-2		2	LSB
E <sub>o</sub> <sup>(1)</sup>	Offset error		-1		1	LSB
E <sub>g</sub> <sup>(1)</sup>	Gain error		-1		1	LSB

1. 由设计保证，不在生产中测试。
2. ADC 的典型应用如下图所示：



对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下，外部输入阻抗的计算公式如下：

$$R_{AIN} = \frac{M}{F_{ADC} * C_{ADC} * (N+1) * \ln(2)} - R_{ADC}$$

其中 $F_{ADC}$ 为 ADC 时钟频率，寄存器 ADC\_CR0[4:2]可设定其与 PCLK 的关系，如下表。

下表为 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 和 PCLK 分频比关系：

ADC_CR0[4:2]	N
000	1
001	2
010	4
011	8
.....	
111	128

M 为采样周期个数，由寄存器 ADC\_CR0[13:12]设定。

下表为采样时间 $t_{sa}$ 和 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 的关系：

ADC_CR0[13:12]	M
00	6
01	8
10	11
11	12

下表为 ADC 时钟频率 $F_{ADC}$ 和外部电阻 $R_{AIN}$ 的关系（M=12,采样误差 0.5LSB 的条件下）：

$R_{AIN}$ (KOhm)	$F_{ADC}$ (KHz)
10	24000
30	22000
35	18000
60	12000
120	6000
180	4000
360	2000
720	1000
1440	500
2200	350
3600	200
7200	100

对于上述典型应用，应注意：

- 尽量减小 ADC 输入端口AIN<sub>x</sub>的寄生电容C<sub>PARACITIC</sub>；
- 除了考虑R<sub>AIN</sub>值外，如果信号源V<sub>AIN</sub>的内阻较大时，也需要加入考虑。

### 7.3.15 TIM 定时器特性

有关输入输出复用功能引脚（输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM 输出）的特性详情，参见下表。

表 7-10 高级定时器 (ATIM) 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res</sub>	定时器分辨时间	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1		t <sub>TIMCLK</sub>
			20.8		ns
f <sub>ext</sub>	外部时钟频率	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	f <sub>TIMCLK</sub> /2	MHz
			0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率	自由计数		16	位
				32	位
T <sub>counter</sub>	选择内部时钟时，16 位计数器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
			0.0208	1363	us
T <sub>MAX_COUNT</sub>	最大可能计数	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		16777216	t <sub>TIMCLK</sub>
				349.5	ms

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 7-11 通用定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res</sub>	定时器分辨时间	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1		t <sub>TIMCLK</sub>
			20.8		ns
f <sub>ext</sub>	外部时钟频率	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	f <sub>TIMCLK</sub> /2	MHz
			0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率			16	位
T <sub>counter</sub>	选择内部时钟时，16 位计数器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
			0.0208	1363	us
T <sub>MAX_COUNT</sub>	最大可能计数	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		2147483648	t <sub>TIMCLK</sub>
				44.7	s

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 7-12 低功耗定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res</sub>	定时器分辨时间	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1		t <sub>TIMCLK</sub>
			20.8		ns
f <sub>ext</sub>	外部时钟频率	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	0	f <sub>TIMCLK</sub> /2	MHz
			0	24	MHz
ReSTim	定时器分辨率			16	位
T <sub>counter</sub>	选择内部时钟时, 16 位计数器时钟周期	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz	1	65536	t <sub>TIMCLK</sub>
			0.0208	1363	us
T <sub>MAX_COUNT</sub>	最大可能计数	f <sub>TIMCLK</sub> =48MHz		2147483648	t <sub>TIMCLK</sub>
				44.7	s

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 7-13 IWDWT 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res</sub>	WDT 溢出时间	f <sub>WDTCLK</sub> =32.8KHz	0.13	64000	ms

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 7-14 WWDT 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>res</sub>	WDT 溢出时间	f <sub>WDTCLK</sub> =48MHz	0.085	699	ms

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

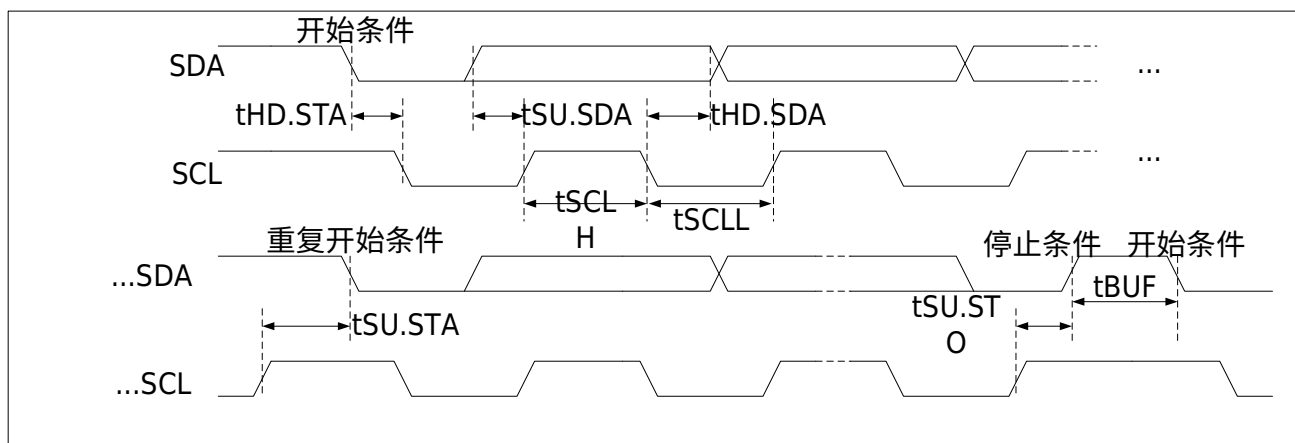
### 7.3.16 通信接口

#### 7.3.16.1 I2C 特性

I2C 接口特性如下表：

表 7-15 I2C 接口特性

符号	参数	标准模式 (100K)		快速模式 (400K)		高速模式 (1M)		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{SCLL}$	SCL 时钟低时间	5		1.25		0.5		us
$t_{SCLH}$	SCL 时钟高时间	5		1.25		0.5		us
$t_{SU.SDA}$	SDA 建立时间	250		100		50		ns
$t_{HD.SDA}$	SDA 保持时间	0		0		0		us
$t_{HD.STA}$	开始条件保持时间	2.5		0.625		0.25		us
$t_{SU.STA}$	重复的开始条件建立时间	2.5		0.625		0.25		us
$t_{SU.STO}$	停止条件建立时间	0.25		0.25		0.25		us
$t_{BUF}$	总线空闲(停止条件至开始条件)	4.7		1.3		0.5		us



1. 由设计保证，不在生产中测试。

图 7-3 I2C 接口时序

### 7.3.16.2 SPI 特性

表 7-16 SPI 接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>c</sub> (SCK)	串行时钟的周期	主机模式 f <sub>PCLK</sub> ≥ 32MHz	62.5		ns
		主机模式 f <sub>PCLK</sub> < 32MHz	2×t <sub>c</sub> (PCLK)		ns
		从机模式 f <sub>PCLK</sub> > 16MHz	8×t <sub>c</sub> (PCLK)		ns
		从机模式 f <sub>PCLK</sub> ≤ 16MHz	4×t <sub>c</sub> (PCLK)		ns
t <sub>w</sub> (SCKH)	串行时钟的高电平时间	主机模式	0.45×t <sub>c</sub> (SCK)	0.55×t <sub>c</sub> (SCK)	ns
		从机模式	0.5×t <sub>c</sub> (SCK)		ns
t <sub>w</sub> (SCKL)	串行时钟的低电平时间	主机模式	0.45×t <sub>c</sub> (SCK)	0.55×t <sub>c</sub> (SCK)	ns
		从机模式	0.5×t <sub>c</sub> (SCK)		ns
t <sub>su</sub> (NSS)	从机选择的建立时间	从机模式	0.5×t <sub>c</sub> (SCK)		ns
t <sub>h</sub> (NSS)	从机选择的保持时间	从机模式	0.5×t <sub>c</sub> (SCK)		ns
t <sub>v</sub> (MO)	主机数据输出的生效时间			3	ns
t <sub>h</sub> (MO)	主机数据输出的保持时间		-2		ns
t <sub>v</sub> (SO)	从机数据输出的生效时间			26 + 2×t <sub>c</sub> (PCLK)	ns
t <sub>h</sub> (SO)	从机数据输出的保持时间		16 + 0.5×t <sub>c</sub> (PCLK)		ns
t <sub>su</sub> (MI)	主机数据输入的建立时间		28		ns
t <sub>h</sub> (MI)	主机数据输入的保持时间		2		ns
t <sub>su</sub> (SI)	从机数据输入的建立时间		2		ns
t <sub>h</sub> (SI)	从机数据输入的保持时间		2 + 1.5×t <sub>c</sub> (PCLK)		ns

1. 由设计保证，不在生产中测试。

SPI 接口信号的波形和时序参数如下：

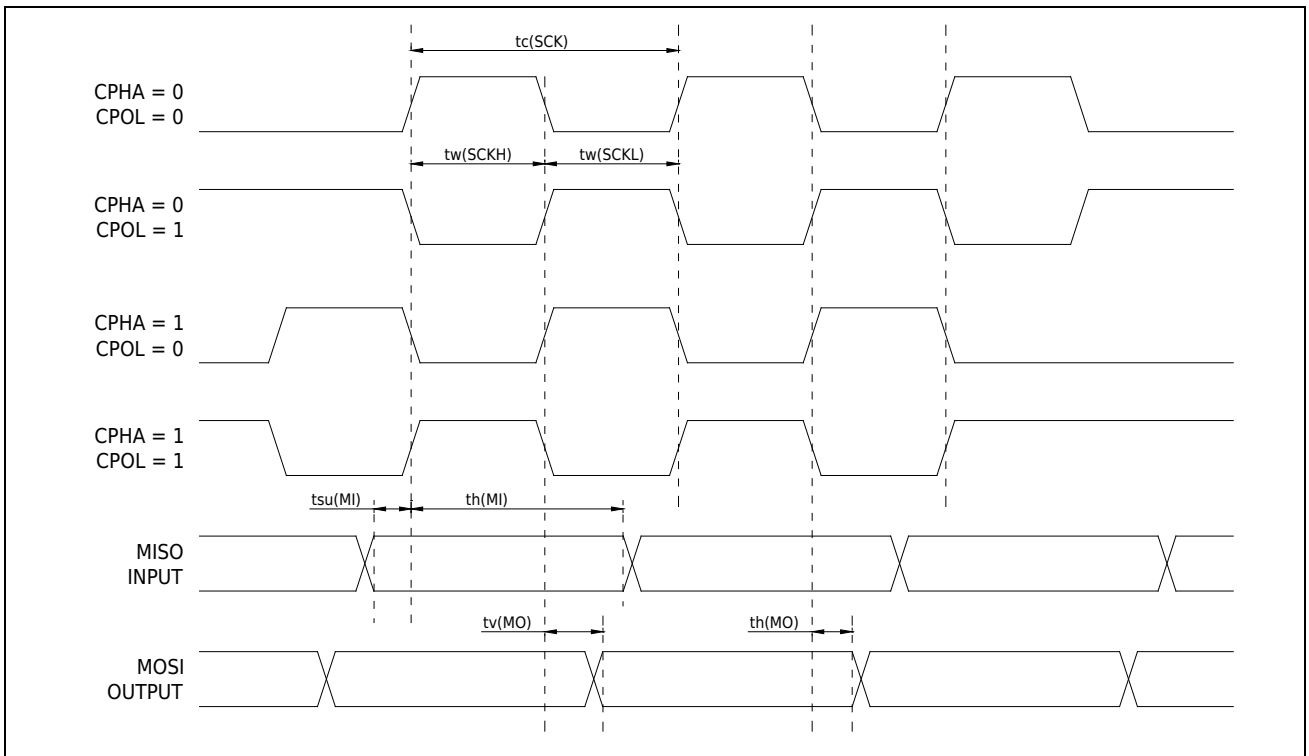


图 7-4 SPI 时序图（主机模式）

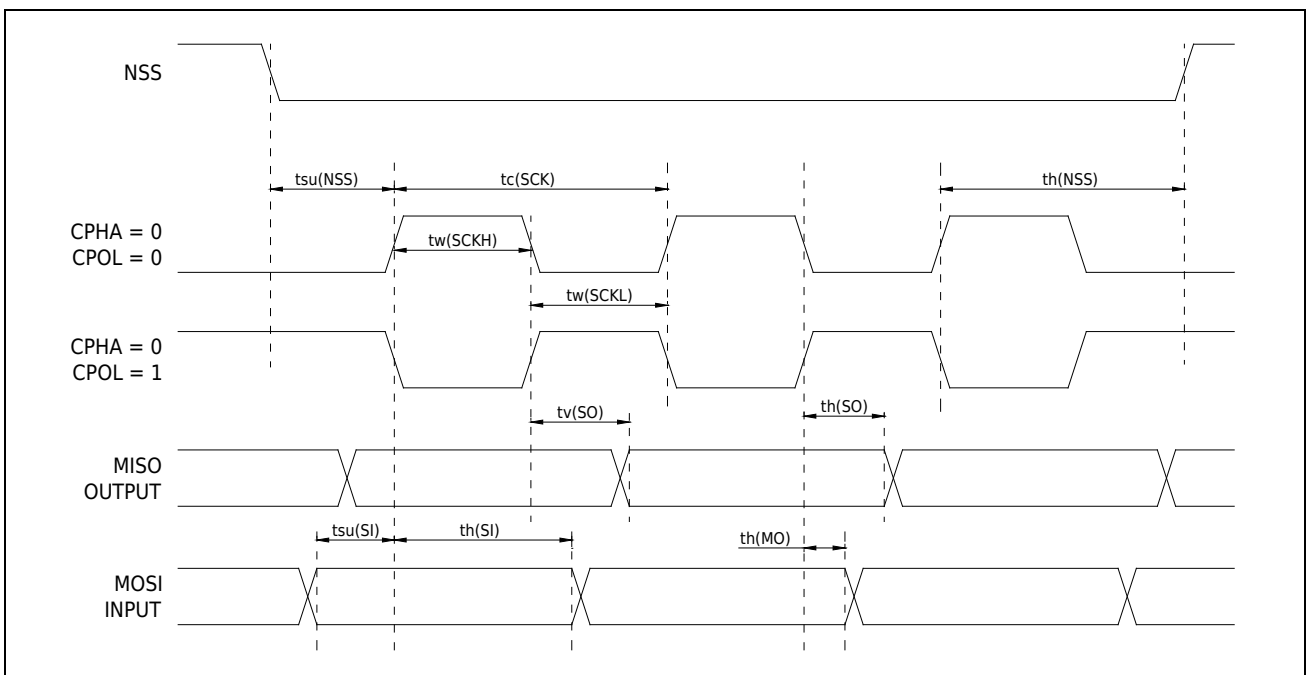


图 7-5 SPI 时序图（从机模式 CPHA=0）

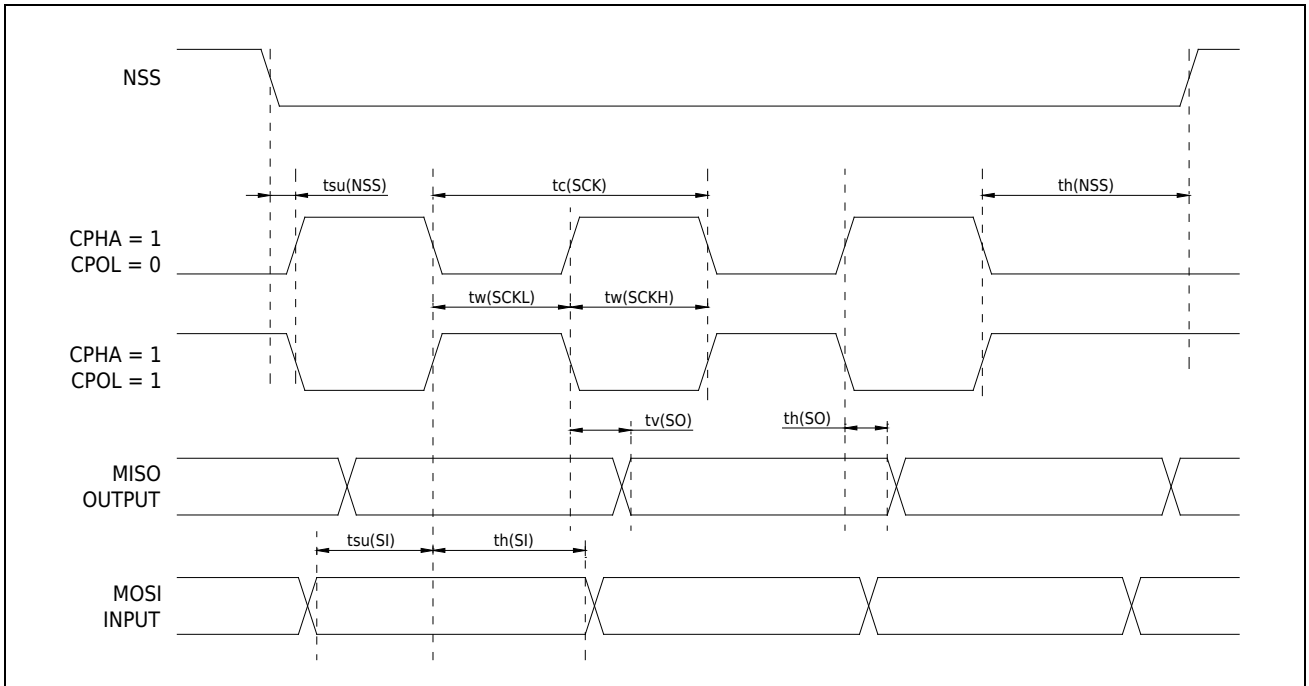


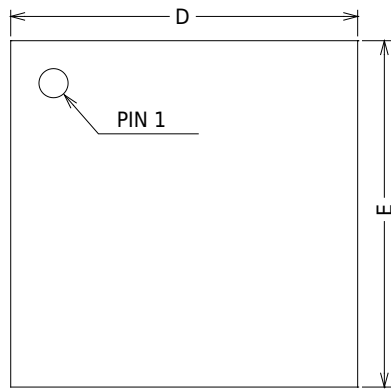
图 7-6 SPI 时序图 (从机模式 CPHA=1)



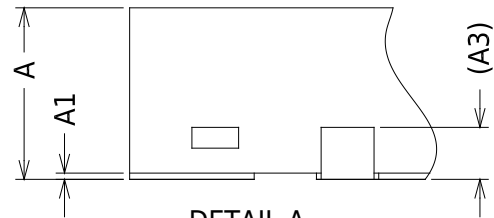
## 8 封装信息

### 8.1 封装尺寸

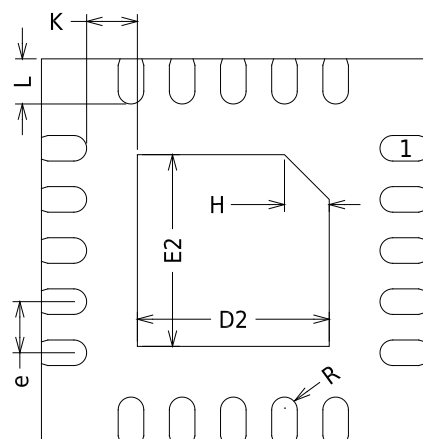
#### QFN20 封装



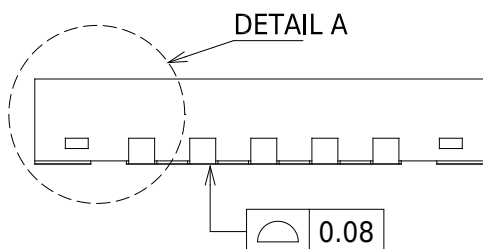
TOP VIEW



DETAIL A

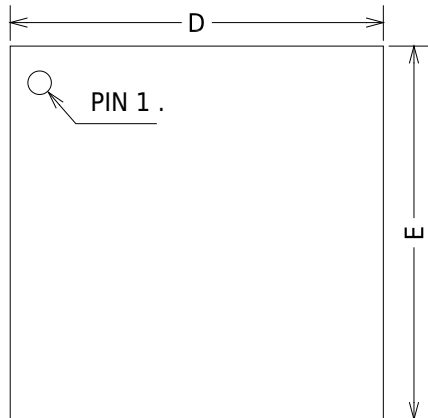


BOTTOM VIEW



Symbol	QFN20 (3x3) millimeter		
	Min	Nom	Max
A	0.50	0.55	0.60
A1	0	0.02	0.05
A3	0.152REF		
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
D2	1.40	1.50	1.60
E	2.90	3.00	3.10
E2	1.40	1.50	1.60
e	0.30	0.40	0.50
H	0.35REF		
K	0.40REF		
L	0.25	0.35	0.45
R	0.075	-	-

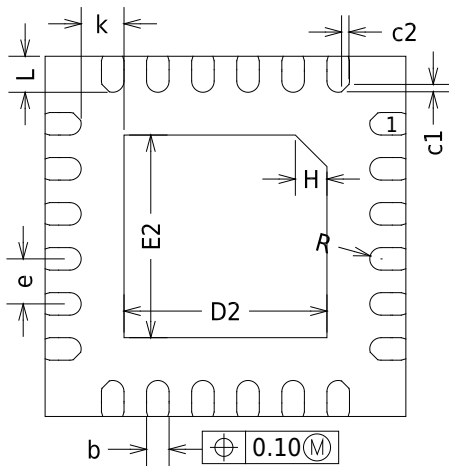
**QFN24 封装**



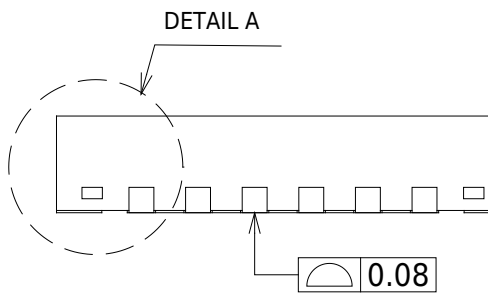
TOP VIEW



DETAIL A

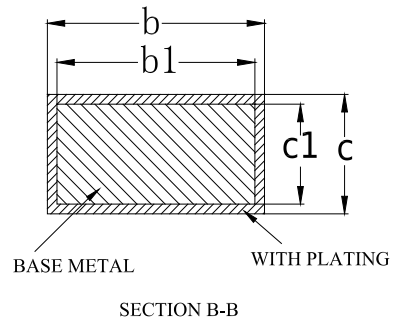
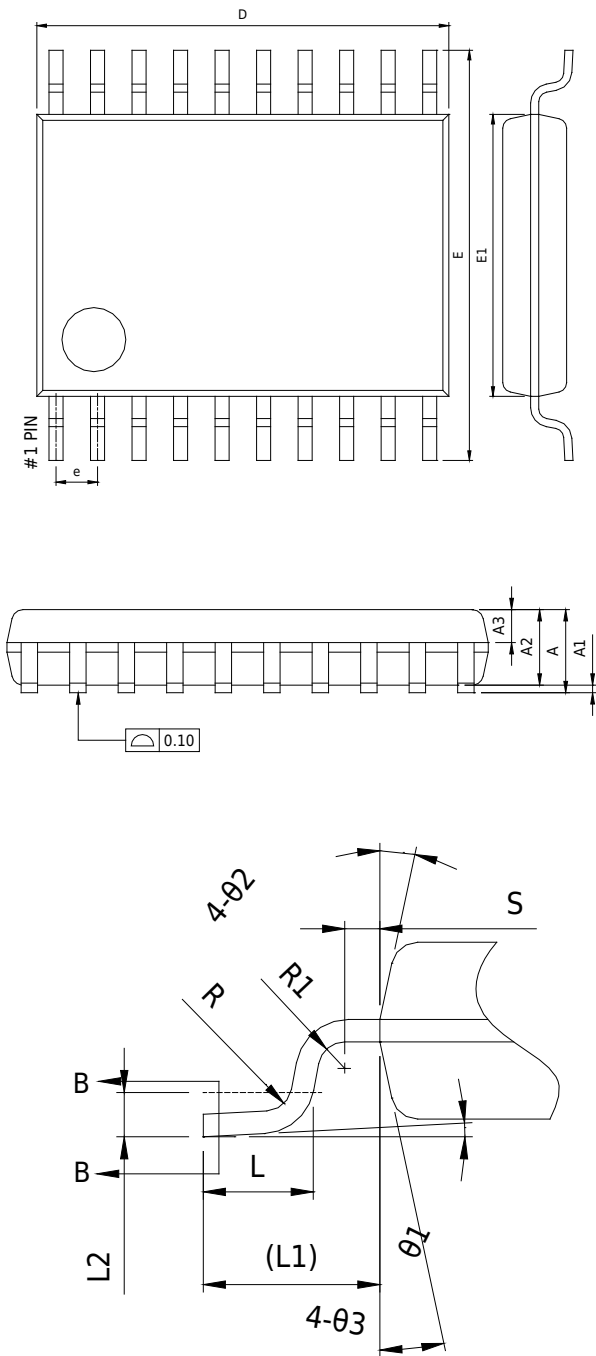


BOTTOM VIEW



Symbol	QFN24 (4x4) millimeter		
	Min	Nom	Max
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	0.20REF		
b	0.20	0.25	0.30
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.15	2.25	2.35
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.15	2.25	2.35
e	0.40	0.50	0.60
L	0.35	0.40	0.45
K	0.30	--	--
H	0.35REF		
R	0.09	--	--
c1	--	0.08	--
c2	--	0.08	--

**TSSOP20 封装**

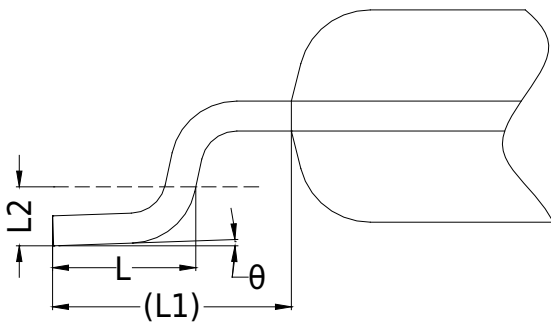
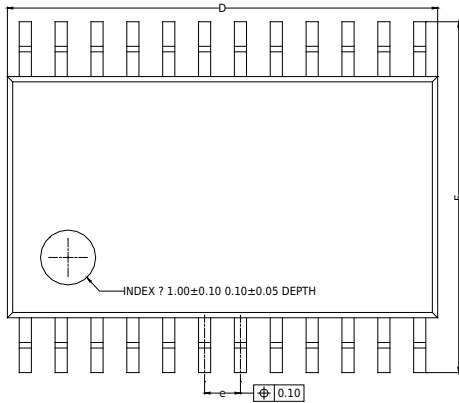
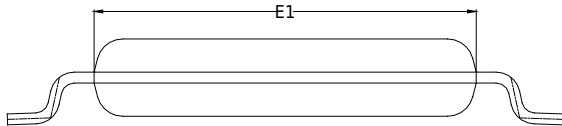
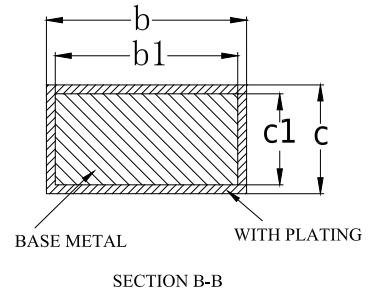
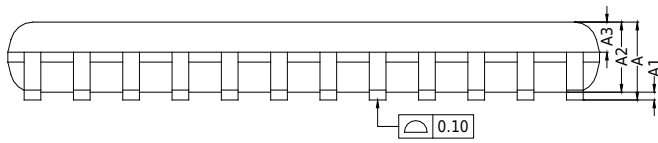


Symbol	TSSOP20 millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.20
A1	0.05	--	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.34	0.44	0.54
b	0.20	--	0.28
b1	0.20	0.22	0.24
c	0.10	--	0.19
c1	0.10	0.13	0.15
D	6.40	6.50	6.60
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R	0.09	--	--
R1	0.09	--	--
S	0.20	--	--
θ1	0°	--	8°
θ2	10°	12°	14°
θ3	10°	12°	14°

**NOTE:**

- Dimensions "D" and "E1" do not include mold flash.

**TSSOP24 封装**



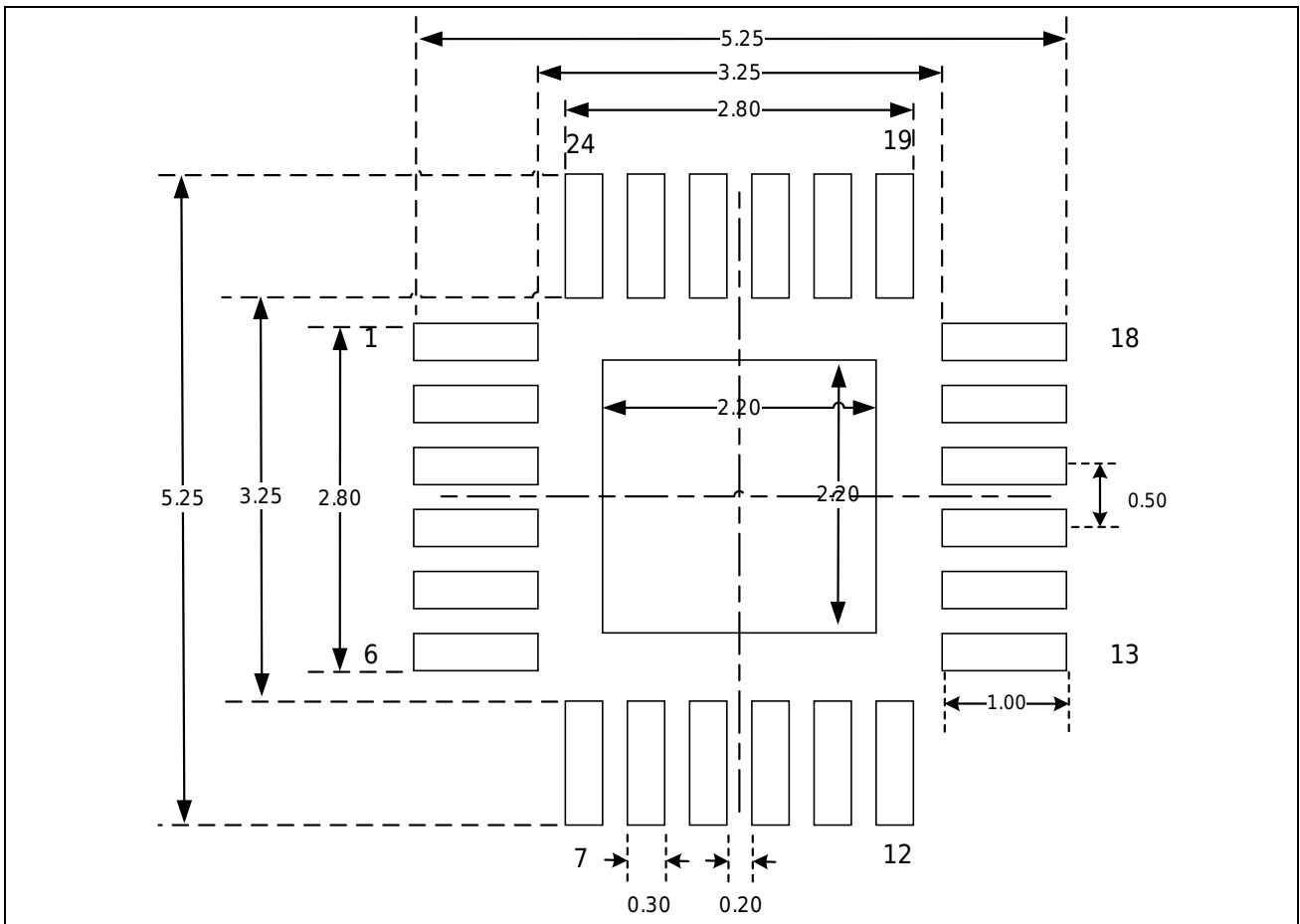
Symbol	TSSOP24 millimeter		
	Min	Nom	Max
A	--	--	1.20
A1	0.05	--	0.15
A2	0.80	0.90	1.00
A3	0.34	0.39	0.44
b	0.20	--	0.29
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.10	--	0.19
c1	0.10	0.13	0.15
D	7.70	7.80	7.90
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.55	0.65	0.75
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
θ	0	--	8°

**NOTE:**

- Dimensions "D" and "E1" do not include mold flash.



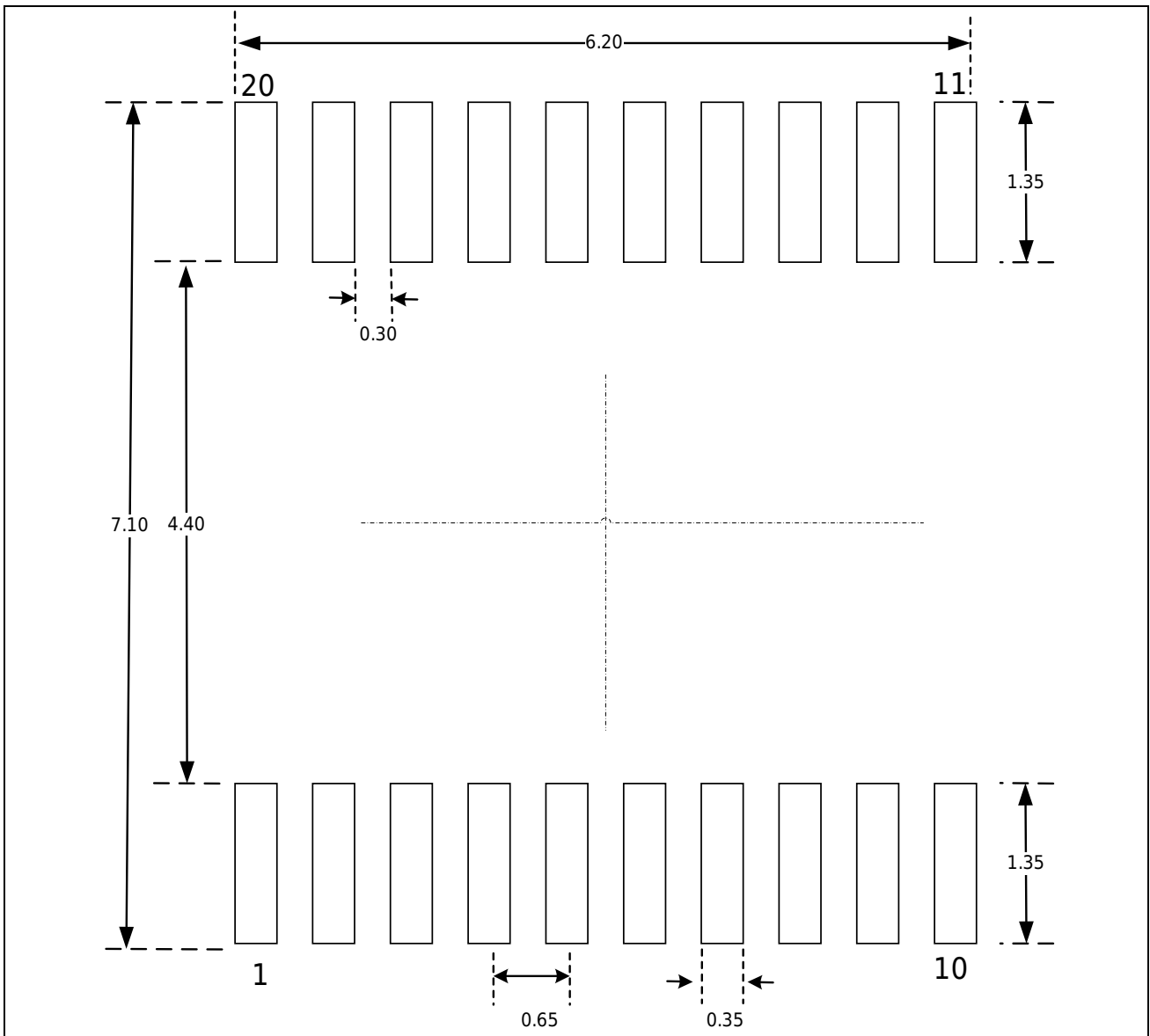
**QFN24 封装 (4mm x 4mm)**



**NOTE:**

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

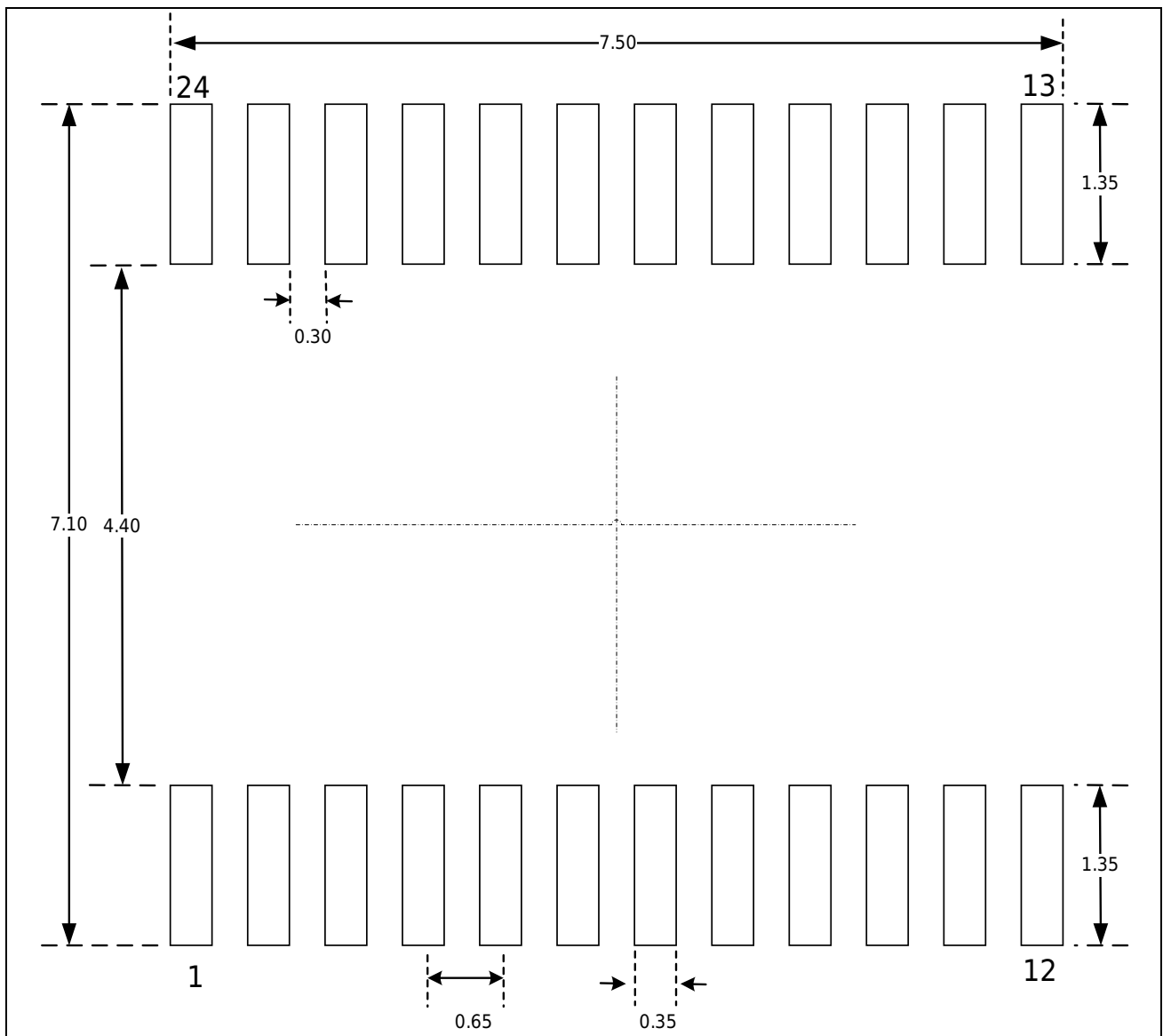
**TSSOP20 封装**



**NOTE:**

- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。

**TSSOP24 封装**



**NOTE:**

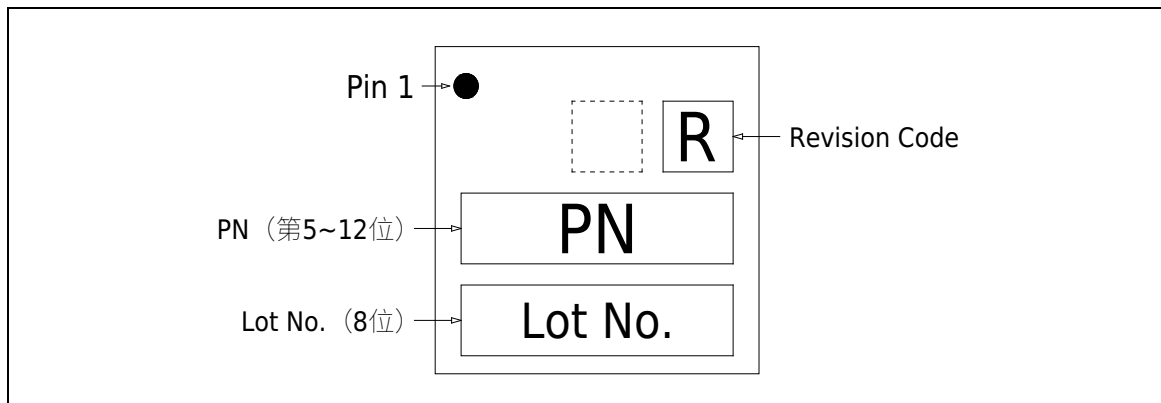
- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。



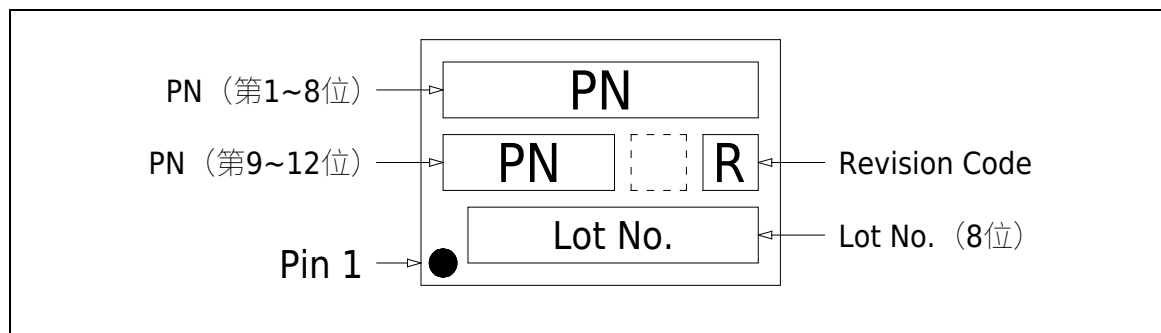
### 8.3 丝印说明

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。

#### QFN20 封装 (3mm x 3mm) / QFN24 封装 (4mm x 4mm)



#### TSSOP20 封装 / TSSOP24 封装



**注意:**

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记，本节不作说明。

## 8.4 封装热阻系数

封装芯片在指定工作环境温度下工作时，芯片表面的结温  $T_j$  (°C) 可以按照下面的公式计算：

$$T_j = T_{amb} + (P_D \times \theta_{JA})$$

- $T_{amb}$  是指封装芯片工作时的环境温度，单位是°C；
- $\theta_{JA}$  是指封装对工作环境的热阻系数，单位是°C/W；
- $P_D$  等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和，单位是 W。芯片的内部功耗是产品的  $I_{DD} \times V_{DD}$ ，I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗，通常该部分值很小，可以忽略。

芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温  $T_j$ ，不可以超出芯片可容许的最大结温  $T_{j0}$ 。

**表 8-1 各封装热阻系数表**

Package Type and Size	Thermal Resistance Junction-ambient Value ( $\theta_{JA}$ )	Unit
QFN20 3mm x 3mm / 0.4mm pitch	70 +/- 10%	°C/W
QFN24 4mm x 4mm / 0.5mm pitch	53 +/- 10%	°C/W
TSSOP20	91 +/- 10%	°C/W
TSSOP24	80 +/- 10%	°C/W

## 9 订购信息

Part number	HC32F002C4PZ-TSSOP20	HC32F002C4PZ-TSSOP20TR	HC32F002C4UZ-ZFN20TR	HC32F002D4PZ-TSSOP24	HC32F002D4PZ-TSSOP24TR	HC32F002D4UZ-QFN24TR
主频 (MHz)	48	48	48	48	48	48
内核	Cortex-M0+	Cortex-M0+	Cortex-M0+	Cortex-M0+	Cortex-M0+	Cortex-M0+
Flash (KB)	18	18	18	18	18	18
RAM (KB)	2	2	2	2	2	2
GPIO	17+1	17+1	17+1	21+1	21+1	21+1
工作电压(V)	1.7 - 5.5	1.7 - 5.5	1.7 - 5.5	1.7 - 5.5	1.7 - 5.5	1.7 - 5.5
低功耗定时器	1	1	1	1	1	1
基本定时器	3	3	3	3	3	3
通用定时器	1	1	1	1	1	1
高级定时器	1	1	1	1	1	1
LPUART	2	2	2	2	2	2
I2C	1	1	1	1	1	1
SPI	1	1	1	1	1	1
ADC(10bit)	11ch	11ch	11ch	14ch	14ch	14ch
LVD	√	√	√	√	√	√
LVR	√	√	√	√	√	√
工作温度(°C)	-20~105	-20~105	-20~105	-20~105	-20~105	-20~105
封装形式	TSSOP20	TSSOP20	QFN20(3*3)	TSSOP24	TSSOP24	QFN24(4*4)
引脚数	20	20	20	24	24	24
脚间距	0.65mm	0.65mm	0.4mm	0.65mm	0.65mm	0.5mm
产品厚度	1.2mm	1.2mm	0.55mm	1.2mm	1.2mm	0.75mm
包装方式	Tube	Tape & Reel	Tape & Reel	Tube	Tape & Reel	Tape & Reel

— 订购前，请联系销售窗口咨询最新量产信息。

## 版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.0	2021/12/31	初稿发布。
Rev1.1	2022/03/09	公司 Logo 更新。
Rev1.2	2022/10/14	1) 新增两个型号：HC32F002C4PZ-TSSOP20TR、HC32F002D4PZ-TSSOP24TR； 2) “引脚配置图”章节，加入 TR 型号，对应图标题修改； 3) “订购信息”章节，加入新增型号，包装方式为 Tape & Reel。

若您在购买与使用过程中有任何意见或建议，请随时与我们联系。

邮箱：support@xhsc.com.cn

电话：021-68667000-7355

地址：上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层

